

業 務

概 覽

我們是誰

我們是一家以智能製造賦能的IC載板供應商，專注於FCBGA、FCCSP、WBCSP及模組載板的研發、製造及銷售。我們的使命是推動技術進步、促進環境可持續發展及造福人類。我們的願景是發展先進IC載板行業，成為全球行業領導者。

IC載板是一種用於半導體封裝的專業高密度互連平台，作為提供硅芯片與印刷電路板之間電氣連接、機械支撐及熱管理的關鍵載體。根據弗若斯特沙利文的資料，按2025年收入計，我們在中國內地的IC載板製造商中排名第三，較2023年的第六名上升，並在FCBGA及FCCSP載板的中國內地製造商中各排名第三。在全球按2025年IC載板收入計前20大IC載板供應商中，我們在2023年至2025年的收入複合年增長率排名第一。我們的收入由2023年的人民幣1,182.9百萬元快速增長至2024年的人民幣2,055.5百萬元及2025年的人民幣2,828.6百萬元，複合年增長率為54.6%。我們的收入進一步增加至截至2026年3月31日止三個月的人民幣923.9百萬元，較2025年同期增長70.9%。

作為IC載板行業的技術領導者，我們策略性地專注於FCBGA載板作為未來的增長動力，我們的主要產品包括FCCSP、WBCSP及模組載板。於2025年，我們深圳園區FCBGA載板的滿載設計產能¹方面達3,360千片，而秦皇島園區FCCSP、WBCSP及模組載板滿載設計產能方面則達2,419千片。

下圖載列我們的主要業務成就：

 行業地位	 全球客戶群	 技術參數
第三 IC載板中國內地廠商排名 (以2025年收入計) 第三 FCBGA載板廠商在中國內地的排名 (以2025年收入計) 第三 FCCSP載板中國內地廠商的排名 (以2025年收入計) 第一 全球前二十大IC載板供應商 (按收入增長複合年增長率計)	前五大 全球OSAT企業 全球前五大中的三家 半導體存儲芯片供應商 全球知名 IC設計及IDM企業	中國內地首家實現單一封裝內 11類及以上芯片Chiplet封裝用IC載板量產 FCBGA • 26層、線寬／線距9/12 μm大規模生產能力 • 中國內地首家通過支持2nm芯片的FCBGA載板認證的企業 FCCSP • ETS 7/10 μm及mSAP 12/16 μm線寬／線距大規模生產能力 • 中國內地首家實現支持3nm智能手機SoC芯片的FCCSP載板大規模生產
	 增長態勢	 智慧工廠
	54.6% 收入增長複合年增長率 174.6% FCBGA載板的營業收入複合年增長率 FCBGA載板收入佔比從2023年的10.8% 增長到2026年第一季度的40.2%	全球IC載板供應商中 率先部署半導體級SECS通訊協議的企業之一 中國內地最大的FCBGA載板工廠⁽¹⁾ 核心工序自動化率超過95%

附註：上圖所載所有行業排名均按弗若斯特沙利文的資料編製。

- (1) 根據弗若斯特沙利文的資料，基於2025年實際裝機產能計。
- (2) 所有複合年增長率乃基於2023年至2025年期間計算。

¹ 基於生產流程中的瓶頸階段。對於FCBGA產品，我們將線路增層（ABF增層）階段視為瓶頸；對於FCCSP、WBCSP及模組產品，我們將表面處理產量視為瓶頸。滿載設計產能指工廠的設計最高產能，根據可置於整體廠房佈局內的設備總量計算。生產時間按期內經例行維護後每月28個滿生產日計算。

業 務

我們的市場機遇

AI時代對算力的不斷增長的需求正提升IC載板的重要性，IC載板可實現高速信號傳輸及有效散熱，以支持穩定、高性能的芯片運算。根據弗若斯特沙利文的資料，由2025年至2030年，全球IC載板市場預期將達303億美元，複合年增長率為15.3%。FCBGA載板預期將成為IC載板市場中增長最快的分部。由2025年至2030年，全球FCBGA載板市場預期將達192億美元，複合年增長率為19.7%。此外，全球FCBGA供需比率預期將由2025年的94.7%上升至2026年的104.7%，超過100%並進入供不應求狀態，其後供不應求缺口持續擴大，並於2030年達到125.6%。海外市場佔據全球FCBGA載板需求的大部分，且增長速度較中國內地更快。根據弗若斯特沙利文的資料，於2025年，FCBGA載板境外市場規模達64億美元，約佔全球FCBGA載板市場的82%，預計2025年至2030年的複合年增長率為20.9%，大幅超越同期中國內地預期的13.3%複合年增長率。作為中國內地IC載板行業中以FCBGA載板為策略重點的新興領導者，我們相信我們處於有利位置以把握該等重大市場機遇。

我們的競爭優勢

中國內地IC載板行業的新興領導者，其價值主張吸引全球行業領先客戶。

我們是中國內地領先的IC載板供應商。根據弗若斯特沙利文的資料，按2025年收入計，我們在中國內地IC載板製造商中排名第三，較2023年的第六名上升，並在FCBGA及FCCSP載板的中國內地製造商中各排名第三。自成立以來，我們一直致力於推動IC載板的工藝優化及實現技術突破，並得到我們的智能製造系統及高素質的技術及管理專業團隊的支持，使我們能夠開發及製造具有高附加值及卓越質量的IC載板。按2025年IC載板收入計，在全球前20大IC載板供應商中，我們在2023年至2025年的收入複合年增長率排名第一。

我們擁有兩個均衡且互補的增長動力支柱：國內及國際行業領先客戶。鑑於IC載板行業的供應短缺及快速技術創新的特性，行業領先客戶（尤其是FCBGA產品方面）要求其IC載板供應商具備全面的能力：(1)快速技術商業化，(2)生產穩定可靠的產品，及(3)快速產能爬坡以滿足日益增長的需求。我們相信我們的價值主張滿足了所有該等要求，因此我們的價值主張對全球行業領先客戶極具吸引力。

技術商業化需要與客戶具備強大的聯合開發能力。我們與全球前五大半導體封裝測試(OSAT)外包服務公司、世界知名的IC設計公司及IDM公司有廣泛的長期合作，並已成為其核心IC載板供應商之一。我們亦與他們在產品早期設計流程及封裝方案評估方面保持深入合作，並根據其定制化技術要求，通常提前六至十二個月啟動研發及驗證活動。

業 務

此外，我們為客戶提供端到端支持。通過貫穿IC設計、IC載板製造及封裝流程的深度聯合優化，我們能夠在「需求預測—技術提升—量產實施—迭代升級」的整個研發週期中與客戶緊密配合，確保我們的長期領導地位及業務擴張。

此外，我們利用採用SEMI設備通訊標準(SECS)協議的智能製造設施，以確保我們的產品在商業化後穩定可靠。智能製造設施亦使我們能夠在產品開發後在不同生產線之間快速複製生產。有關更多詳情，請參閱「—採用SECS通訊協議的世界級智能製造能力」。我們穩定可靠的產品體現在主要下游客戶的高度認可，並獲全球多家知名客戶授予「年度最佳供應商」等榮譽，展示了我們在產品質量、技術實力、交付表現及服務響應能力方面的行業領先能力。

此外，憑藉我們在中國內地的早期投資策略及智能製造能力，我們能夠快速提升產能。就未來的產能擴張而言，與國際競爭對手相比，我們亦受惠於中國內地較低的廠房建設成本及更高效的建設週期。有關更多詳情，請參閱「—快速產能爬坡以把握全球AI機遇並擴大領先AI客戶基礎」。

快速產能爬坡以把握全球AI機遇並擴大領先AI客戶基礎

隨著AI技術在全球的快速應用，行業正面臨高端IC載板產能的嚴重短缺，領先客戶正加速其擴張計劃以滿足激增的算力需求。因此，領先客戶在選擇像我們這樣的IC載板生產合作夥伴時，會高度重視其合作夥伴的產能爬坡能力。在此背景下，我們策略性地預見未來的產能需求，並在初步廠房設計中納入大量產能擴充空間，同時採用分階段設備安裝的方法，以在實際訂單增長時快速提升產能。2025年，我們在深圳及秦皇島的生產廠房對FCBGA載板的滿負荷設計總產能為3,360千片，對FCCSP、WBCSP及模組載板的滿負荷設計總產能為2,419千片。我們亦採用分階段設備安裝的策略，在實際訂單增長時快速提升產能。我們的實際裝機產能由2023年FCBGA載板的856千片及FCCSP、WBCSP及模組載板的1,668千片增加至2025年FCBGA載板的1,050千片及FCCSP、WBCSP及模組載板的1,964千片。憑藉此快速提升能力，我們的實際產量由2023年FCBGA載板的116千片及FCCSP、WBCSP及模組載板的1,148千片增加至2025年FCBGA載板的727千片及FCCSP、WBCSP及模組載板的1,726千片，複合年增長率分別為150.3%及22.6%，而我們現有生產廠房的實際裝機產能仍有充足空間可進一步提升。

此外，我們相信與國際競爭對手相比，我們在進一步提升產能方面具有競爭優勢。根據弗若斯特沙利文的資料，中國內地以外地區年產能約為2,000千片的IC載板製造設施的建設及爬坡至量產通常需要約五年，而我們能夠在中國內地在兩年至兩年半內完成同類設施的建設並開始量產，展示了我們在提供定制化高端產能擴張及快速產量爬坡方面的卓越能力。

業 務

持續研發、技術提升及IC載板升級以構建強大的技術壁壘

通過對研發及技術提升的投入，我們已建立涵蓋產品設計、材料應用及製造工藝的全棧式核心技術體系。我們擁有從研究、產品開發到工藝實施及量產的全流程集成工程能力，能夠快速實現研發成果的商業化，深化及拓寬與下游客戶的合作，並使我們處於全球IC載板行業的前沿。

就FCBGA而言，我們已策略性地將我們的技術佈局於高性能計算芯片的主流先進封裝工藝中。我們的技術使我們的產品能夠實現三大主要特點：大尺寸及高層數、低翹曲、高精度。根據弗若斯特沙利文的資料，我們的FCBGA載板定位於行業領先水平，能夠支持採用2nm工藝節點製造的高性能計算芯片的先進封裝要求。我們已實現與先進Chiplet及異構集成封裝以及2.5D/3D堆疊IC封裝架構兼容的IC載板的大規模量產。根據弗若斯特沙利文的資料，我們亦是中國內地首家實現單一封裝內11顆及以上芯片Chiplet封裝IC載板大規模生產的企業。

此外，我們持續追蹤AI計算芯片封裝技術的最新發展趨勢，並主動啟動用於先進封裝的下一代IC載板技術的研發，包括元件嵌入式FCBGA載板、多層芯FCBGA載板、超薄FCBGA載板及無核心層FCBGA載板。這一研發策略確保我們的技術路線圖保持領先於市場需求，並為我們在高性能計算芯片等高增長領域的長期競爭力提供堅實基礎。

就FCCSP載板而言，我們利用在FCCSP載板的精細線路、微孔結構及薄型化設計方面的技術優勢，為客戶提供高度集成、具成本效益的一站式解決方案。根據弗若斯特沙利文的資料，我們是中國內地首家實現行業領先的FCCSP載板量產的公司，該載板能夠支持3nm智能手機SoC芯片。

截至最後實際可行日期，我們獲得了236項專利，包括188項發明專利及48項實用新型專利，並提交了75項專利申請，在先進IC載板領域形成堅實的知識產權壁壘。我們相信，我們持續的研發投入及技術升級將進一步鞏固我們的技術領導地位並增強我們的長期競爭力。

採用SECS通訊協議的世界級智能製造能力

根據弗若斯特沙利文的資料，我們是中國內地IC載板行業中最早實現智能製造的企業之一，我們的核心生產基地實現了完全集成的智能生產，並在全球IC載板行業中保持先進水平。特別是，我們是全球首批採用半導體行業先進SECS通訊協議的IC載板供應商之一，使我們能夠在整個產品生命週期中積累寶貴的數據洞察，並確保生產參數保持穩定、可控及可追溯。這種可追溯性及穩定性確保了我們IC載板的可靠性及質量。

業 務

以實現設備狀態監控、生產配方下載及共享、數據收集及警報通知的統一管理，我們已採用SECS通訊協議，該協議要求我們所有的智能製造設施配備端到端自動化生產設備、半導體智能製造軟件，以及支持AI的產品設計及質量檢測系統。我們的端到端自動化運營涵蓋從原材料入庫、製造到成品出庫及物流的整個生產流程，大幅提高了生產效率。我們亦將AI整合到IC載板的生命週期質量管理系統中，實現AI在產品設計及生產檢測中的應用。

我們在SECS通訊協議下的生產能力對於半導體級產品至關重要，因為所有業務數據均實時共享並集中管理，使管理層能夠遠程監控生產、精準調度資源及作出更明智的決策，顯著提高了質量和運營效率。此外，由於所有業務數據均自動管理及監控操作，我們能夠在不同的智能製造設施之間複製特定產品的生產，而無需人手調整生產參數（該過程耗時且不可靠）。

依托穩定的供應鏈能力，保障快速且優質的產品交付能力

我們高度重視供應鏈韌性，並與全球領先的IC載板材料、設備及軟件供應商聯合開發，實現相互技術賦能及持續改進，同時提高我們的生產效率及產品性能。我們已與IC載板原材料（如ABF、CCL、金鹽及防焊油墨）的主要供應商建立長期穩定的關係。這使我們能夠獲得可靠、高質量及優先的關鍵材料供應，並有效緩解關鍵材料供應緊張對我們生產的影響。同時，憑藉我們與供應商的長期關係，以及我們與客戶在採購方面的合作，我們持續優化採購流程，為保持我們產品的市場競爭力奠定堅實基礎。

在設備方面，我們與設備供應商合作，根據先進IC載板的工藝要求聯合開發專用解決方案，使其與我們的製造流程保持一致，並提高生產效率及產品質量。在軟件體系方面，我們與領先的工業軟件企業合作開發了定製化MES系統，結合我們的生產管理需求與IC載板的生產特點，搭建了全數字化生產管理平台，實現了生產數據的實時採集、分析、優化與追溯，為我們的技術研發與生產工藝優化提供了強大的數字化支撐。

經驗豐富的管理團隊及創新驅動的企業文化支持持續增長

我們的研發、製造、質量及銷售團隊具有深厚的IC載板行業經驗，是推動我們長期發展的中堅力量。截至最後實際可行日期，我們擁有超過三百名在IC載板行業擁有超過10年經驗的工程師，具備深厚的行業積累、精準的技術判斷力與強大的執行力，為我們的技術創新、戰略落地與長期穩定發展奠定了堅實的人才基礎。我們高度重視人才的引進、培養與激勵，構建了完善的人才發展體系和激勵機制，為我們在全球IC載板市場的競爭提供了強大的人才支撐。

業 務

我們的董事長李定轉先生擁有豐富的IC載板市場開拓與運營管理經驗，是IC載板行業的資深專家與開拓者之一，他帶領建立了多個IC載板製造設施，對FCBGA生產進行大規模投資，帶領本公司成為全球IC載板供應商中首家部署半導體級SECS通訊協議的公司，積累了豐富的高階IC載板研發、生產與管理經驗。尤其是，李先生牽頭建立了我們專注於FCBGA載板的團隊，並推動了我們FCBGA載板業務的發展，包括技術路線圖的制定以及相關研發及生產能力的建設。憑藉對行業的技術發展趨勢、市場競爭格局、客戶需求變化具備深刻的洞見，李先生展現豐富的戰略願景以及精準的判斷力，是我們戰略發展的核心引領者。

我們的成長戰略

拓展我們的全球領先客戶基礎

我們旨在通過擴大全球領先客戶基礎來推動增長。憑藉我們快速的技術商業化、產能爬坡及成本效率，我們通過高性能及定制化的IC載板直接滿足IC設計公司的需求，同時把握由AI時代對AI及HPC應用日益增長的需求驅動的國際FCBGA機遇。有關更多詳情，請參閱「我們的競爭優勢—中國內地IC載板行業的新興領導者，其價值主張吸引行業領先的全球客戶」。

隨著AI相關技術持續進步及客戶進一步縮短其產品開發週期，我們將深化價值鏈上下游的合作，並加強我們以客戶為導向的聯合開發模式。我們將專注於加快材料及工藝迭代、縮短新技術及新產品的研發週期，以及提升我們的快速設施建設及靈活資源配置能力，以配合客戶的下一代產品路線圖。我們亦將尋求更早參與客戶的產品開發及技術驗證，以加深對設計限制的理解，並支持載板設計、材料及工藝的針對性優化，從而提高驗證效率、上市時間、質量穩定性及交付一致性。同時，我們旨在通過快速的產能爬坡能力、高且穩定的產品質量及智能製造系統吸引領先的全球客戶，使我們能夠滿足全球對性能、可靠性及交付的嚴格要求。

從供應方面而言，我們將加強與主要原材料及設備供應商的合作，加強ABF及CCL等關鍵材料的供應保障及認證時間表的協調，並推動供應商多元化，以建立更穩定及更具韌性的供應鏈，這對領先的全球客戶亦至關重要。

從客戶方面而言，我們亦將擴大與全球領先OSAT、IC設計及IDM客戶的合作，加強我們的全球營銷及技術支持網絡，並擴大國際業務拓展，以更好地滿足不同應用場景對IC載板的差異化要求，為我們境外業務的持續擴張奠定堅實基礎。

快速提升產能並持續增強智能製造

在我們現有的量產管理系統及智能製造基礎上，我們將加快新產能的爬坡及產能釋放速度，以便在匹配客戶訂單及預期需求的同時快速增加產品供應。

業 務

- **FCBGA載板：**我們計劃在未來數年專注於擴大深圳FCBGA載板的產能。我們還計劃進一步將我們的產能組合轉向7納米及以下的先進工藝節點，以更好地滿足中國內地及全球領先客戶在AI及HPC、汽車及機器人及網絡通信等領域的需求。我們計劃擴充深圳二號廠房的產能並投資建設若干個新廠房，包括土地使用及建築成本，同時加快先進設備的採購及安裝，並部署自動化解決方案以支持我們的生產。
- **FCCSP載板：**受惠於存儲芯片市場蓬勃增長及邊緣AI應用對高度集成封裝不斷增長的需求，我們秦皇島一號及二號廠房的滿載設計產能利用率於截至2026年3月31日止三個月分別達到96.0%及65.9%。我們將繼續鞏固我們在存儲及邊緣AI應用的FCCSP載板領域的領先地位，同時推進相應產能的建設，為預期的訂單量增長提前做好準備。

同時，我們將利用智能製造作為產能擴張的關鍵推動力，持續優化我們的生產流程、關鍵工藝參數及質量控制系統。這將提高產品的一致性和穩定性，降低與複雜工藝相關的製造風險及返工損失，並確保可靠的可擴展性。我們還將繼續按照智能工廠的高標準引進先進設備，進一步提高我們製造流程的自動化及精密度，並推動單位生產成本的不斷優化。

持續聚焦IC載板產品研發，加快技術迭代，鞏固市場領先地位

作為中國內地領先的IC載板廠商，我們將持續聚焦高階IC載板的技術能力建設。因應AI及HPC、智能裝置等下游應用領域日益增長的需求，以及先進封裝對更高互連密度、信號完整性、散熱性能及可靠性的需求，我們將加速產品及製造工藝的技術迭代。我們將持續提升高階產品在性能穩定性、依賴性及應用適配範圍等方面的綜合表現，從而更好匹配下游客戶及應用場景的升級需求。我們亦將持續投入研發物料採購、全球研發人才招聘與培訓，以及先進設備的採購與調試，以支持我們的長期技術路線圖。

在AI及HPC領域，我們將重點面向大模型訓練、超算中心及高性能推理等應用場景，推進適配2.5D/3D堆疊封裝、Chiplet及異構集成封裝及先進制程的FCBGA載板的技術升級與產品迭代。與此同時，我們將積極順應行業技術趨勢，前瞻性地部署下一代IC載板，如大尺寸、高層數、低翹曲及高精度等方向，以更好響應高性能算力芯片等關鍵客戶對高帶寬互連與高可靠封裝的需求。

在智能裝置領域，隨著端側AI硬件持續向輕薄化、小型化與高集成度方向演進，終端側對封裝的小型化與更高I/O密度提出更高要求。我們將圍繞上述趨勢，推進面向端

業 務

側AI應用的FCCSP等產品的技術研發與迭代，重點在更高層數、更細線寬／線距與更高互連密度等方向持續優化產品與工藝能力，以支持終端應用對體積、性能與可靠性的綜合要求。

持續吸引人才，建設穩定國際化團隊

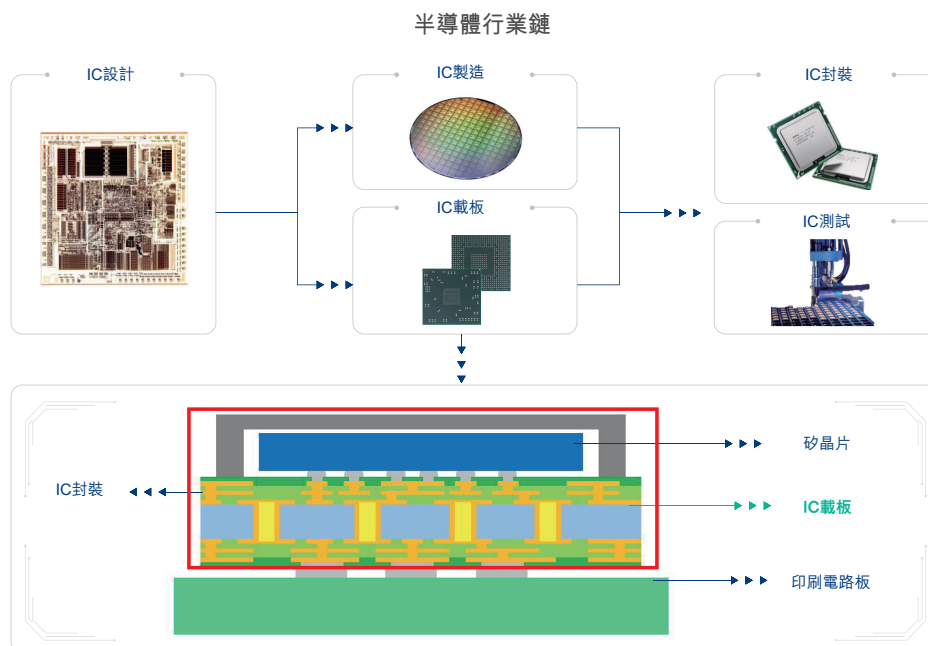
我們致力於營造一個包容且充滿活力的工作環境，以吸引及留住全球頂尖人才，並輔以具競爭力、與市場接軌的薪酬及激勵機制。我們將通過分層人才培養體系，強化我們的培訓、職業發展及繼任規劃框架，同時完善基於績效的激勵措施，並培育有凝聚力、高績效的組織文化，以支持公司的全球擴張及長期增長。

我們亦將通過系統性的內部培養，輔以有針對性的外部招聘（包括與大學合作培養未來人才），並以前瞻性視角專注於核心能力建設及與我們全球業務布局相協調，從而打造一支由研發、製造及業務拓展領域組成的高素質全球人才隊伍。我們亦將通過設立服務全球領先OSAT、IDM及IC設計公司的專屬服務團隊，並通過專門的業務及技術人員加強我們的全球佈局，從而增強我們的客戶服務能力。

我們的產品

概覽

我們的主要產品為IC載板。IC載板是一種用於半導體封裝的專業高密度互連平台，作為提供硅芯片與印刷電路板之間電氣連接、機械支撐及熱管理的關鍵載體。IC載板通常需要精細線路及多層結構，以滿足客戶對電氣性能、信號完整性及熱管理的要求。



業 務

於往績記錄期間，我們的IC載板包括FCBGA、FCCSP、WBCSP及模組載板。下表載列我們於所示期間按產品類型劃分的收入明細：

	截至12月31日止年度						截至3月31日止三個月					
	2023年		2024年		2025年		2025年		2026年			
	人民幣		人民幣		人民幣		人民幣		人民幣			
	千元	(%)	千元	(%)	千元	(%)	千元	(%)	千元	(%)	千元	(%)
							(未經審計)					
IC載板												
FCBGA	128,187	10.8	538,359	26.2	966,610	34.2	181,411	33.6	371,534	40.2		
FCCSP	690,680	58.4	1,024,964	49.9	1,102,155	39.0	234,867	43.5	310,718	33.6		
WBCSP及模組	296,509	25.1	398,612	19.4	606,974	21.5	98,547	18.2	183,048	19.8		
出售廢料材料及 其他 ⁽¹⁾	67,486	5.7	93,587	4.5	152,883	5.3	25,701	4.7	58,589	6.4		
總計	<u>1,182,862</u>	<u>100.0</u>	<u>2,055,522</u>	<u>100.0</u>	<u>2,828,622</u>	<u>100.0</u>	<u>540,526</u>	<u>100.0</u>	<u>923,889</u>	<u>100.0</u>		

附註：

(1) 其他主要包括租金收入。

下表載列我們於所示期間按產品類型劃分的IC載板銷量及平均售價明細：

	截至12月31日止年度						截至3月31日止三個月					
	2023年		2024年		2025年		2025年		2026年			
	銷量	ASP	銷量	ASP	銷量	ASP	銷量	ASP	銷量	ASP	銷量	ASP
	(件)	人民幣 元	(件)	人民幣 元	(件)	人民幣 元	(件)	人民幣 元	(件)	人民幣 元	(件)	人民幣 元
FCBGA	12,706	10,089	68,314	7,881	123,315	7,839	22,037	8,232	47,233	7,866		
FCCSP	530,235	1,303	718,904	1,426	774,094	1,424	162,752	1,443	203,920	1,524		
WBCSP及 模組	374,971	791	467,150	853	696,124	872	108,502	908	200,224	914		
總計	<u>917,912</u>	<u>1,289</u>	<u>1,254,367</u>	<u>1,639</u>	<u>1,593,532</u>	<u>1,775</u>	<u>293,290</u>	<u>1,843</u>	<u>451,378</u>	<u>2,047</u>		

附註：

(1) 平均售價的計算方法為特定產品類別的收入除以相應的銷量。

於往績記錄期間，我們所有IC載板類型的銷量顯著增長，主要受強勁的市場需求以及我們的產能增長所推動。有關中國內地及全球IC載板的市場需求，請參閱「行業概覽」。各產品類別內的產品組合變動通常會影響平均售價的變化。然而，於往績記錄期間，我們各產品類型的毛利率顯著提升。有關更多詳情，請參閱「財務資料—綜合損益表的主要組成部分—毛損／毛利及毛利率」。

業 務

我們產品的應用

我們的IC載板可按應用分為智能裝置、AI及HPC、存儲、汽車及機器人以及網絡通信。

下表載列我們於所示期間的收入明細：

	截至12月31日止年度						截至3月31日止三個月			
	2023年		2024年		2025年		2025年		2026年	
	人民幣 千元	(%)	人民幣 千元	(%)	人民幣 千元	(%)	人民幣 千元 (未經審計)	(%)	人民幣 千元 (未經審計)	(%)
IC載板										
智能裝置	809,909	68.5	1,232,480	60.0	1,362,350	48.2	273,742	50.6	401,321	43.4
AI及HPC	26,894	2.3	361,052	17.6	716,217	25.3	130,200	24.1	300,904	32.6
存儲 ⁽¹⁾	175,309	14.8	194,897	9.5	352,205	12.5	60,357	11.2	102,628	11.1
汽車及機器人	22,203	1.9	89,039	4.3	79,235	2.8	7,158	1.3	36,728	4.0
網絡通信	81,061	6.9	84,467	4.1	165,732	5.9	43,368	8.0	23,719	2.6
出售廢料材料及 其他 ⁽²⁾	67,486	5.6	93,587	4.5	152,883	5.3	25,701	4.8	58,589	6.3
總計	1,182,862	100	2,055,522	100	2,828,622	100	540,526	100	923,889	100

附註：

(1) 存儲乃單獨呈列，因其應用於本表所列以外的其他應用領域。

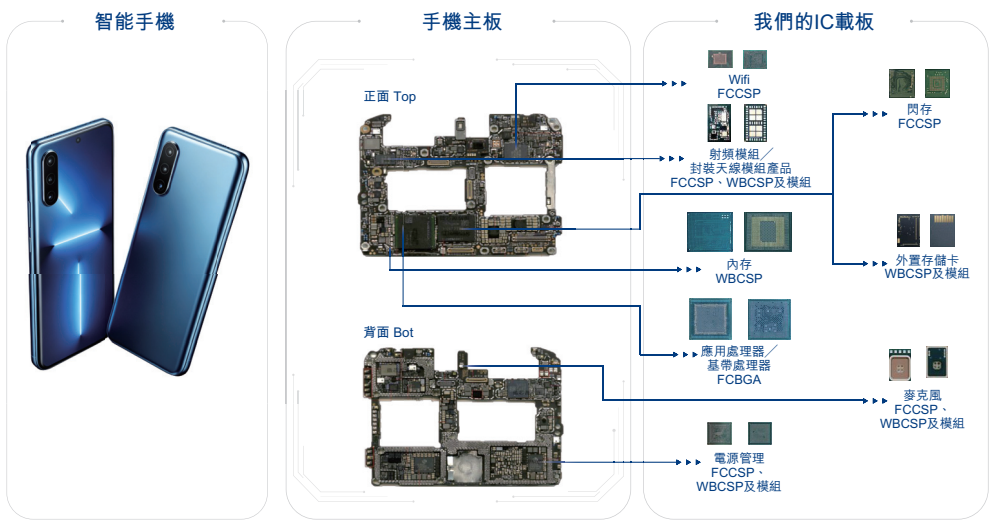
(2) 其他主要包括租金收入。

智能裝置

智能裝置應用受個人電腦、智能手機、平板電腦及穿戴設備的持續升級所推動。隨著該等設備變得更薄、更輕及功能更強大，它們需要支持高集成度、穩定信號傳輸、高密度互連以及高效電源及熱管理的IC載板。我們的IC載板用於關鍵芯片及模組，在廣泛的智能裝置應用中支持計算、通信、感測、音頻、電源管理及連接功能。

業 務

下圖為我們的產品集成至智能手機的示意圖：



下表載列我們用於智能裝置應用領域的產品、目標芯片類型、應用場景及主要設計特色：

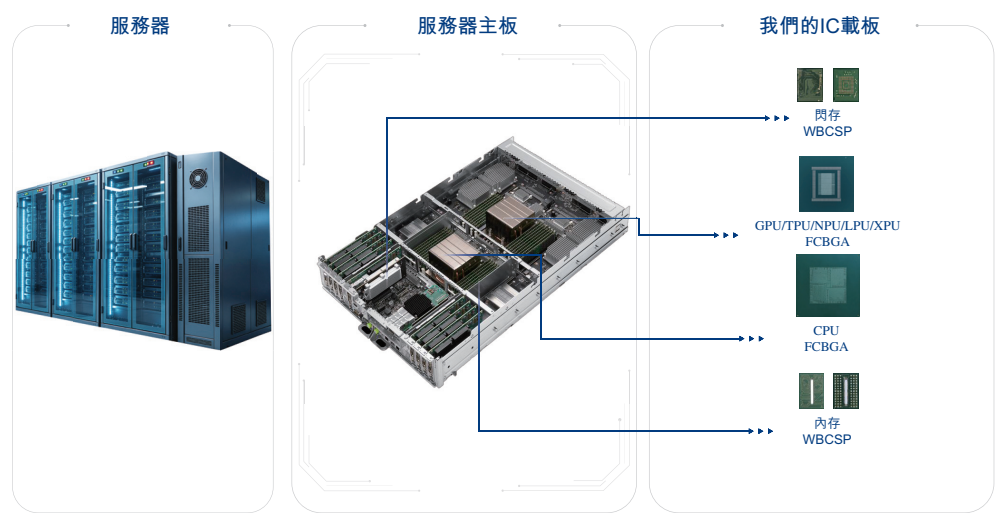
產品	芯片種類	應用場景	設計特色
FCBGA	CPU/GPU	台式電腦、筆記本電腦	● 個人電腦的算力核心，優化成熟工藝，側重於製造穩定性及成本優化 ● 層數：6–16層 ● 尺寸：20–70mm
FCCSP	應用處理器、基帶處理器、WiFi、射頻模組器、電源管理集成電路	高階及AI智能手機、高階平板電腦	● 專為高端智能手機及平板電腦設計，強調高集成度SoC設計及高密度互聯 ● 層數：2–5層 ● ETS線路低至7/10um（開發中產品低至6/8um），mSAP線路低至12/16um
WBCSP及模組	電源管理、麥克風、射頻模組及AiP（封裝天線）模組	智能手機、智能穿戴設備	● 解碼芯片注重能效和解碼質量，電源管理集成電路注重高效能電源轉換，微機電系統麥克風注重高聲電轉換，而模組產品注重高頻訊號傳輸，優化射頻性能及散熱表現 ● 層數：2–9層 ● mSAP線路低至25/25um，蝕刻減成法線路低至25/30um

業 務

AI及HPC

AI及HPC應用是IC載板最具前景及高增長的應用領域之一。在生成式AI、雲計算、高性能計算及大規模數據處理快速發展的推動下，AI及HPC日益需要具有更高計算能力、更高I/O密度、更快信號傳輸及更佳熱管理功能的高級計算芯片。該等趨勢創造了對高性能IC載板(尤其是FCBGA載板)在大尺寸、高層數、精細線路方向的強勁需求，其對於支持AI及HPC基礎設施中使用的AI加速器、CPU、GPU及其他先進處理器至關重要。

下圖為我們的產品集成至服務器的示意圖：



下表載列我們用於AI及HPC應用領域的產品、目標芯片類型、應用場景及主要設計特色：

產品	芯片種類	應用場景	設計特色
FCBGA	CPU/GPU/TPU/NPU/LPU/XPU	AI服務器、高性能運算、通用服務器、雲計算節點	● 專為支持增強計算性能而設計，具備超高層數佈線及高I/O密度，兼容2.5D/3D封裝及Chiplet異構集成 ● 層數：8至26層 ● 本體尺寸：35至120毫米(開發中產品的單邊尺寸將超過150毫米) ● 半加成工藝線寬／線距精細至9/12μm，鏤射孔徑小至40μm，微焊球數量超過30,000個，下一代產品預期將超過100,000個

業 務

存儲

存儲是IC載板一個快速增長的應用領域，受益於智能手機、個人電腦、數據中心、汽車電子及AI相關應用對數據存儲及高速數據處理日益增長的需求。近年來，雲計算、生成式AI、邊緣設備及智能終端的擴張推動了存儲容量、帶寬及性能的持續升級。該等趨勢增加了對可靠且緊湊的IC載板的需求，以支持存儲芯片的穩定電氣性能、高效信號傳輸及大規模生產。下表載列我們用於存儲應用領域的產品、目標芯片類型、應用場景及主要設計特色：

產品	芯片種類	應用場景	設計特色
WBCSP	低功耗雙倍數據速率存儲、動態隨機存取存儲、NAND閃存、多媒體存儲卡	智能手機、智能穿戴設備、服務器、個人電腦、汽車	- 在緊湊及超薄外形尺寸內實現穩定的電氣連接及機械支撐，支持高速讀寫、高帶寬及低延遲，確保高效數據處理 - 層數：2至4層 - mSAP線寬／線距精細至25/25 μm，蝕刻減成法線寬／線距精細至30/30 μm

汽車及機器人

汽車及機器人的快速演進正為IC載板應用開拓新機遇。在汽車及機器人領域，由智能座艙、自動駕駛及先進傳感驅動的智能化發展，需要緊湊、可靠的計算平台。這對IC載板在封裝可靠性、電氣性能、小型化及熱管理方面施加了嚴格要求，支持持續的長期需求增長。下表載列我們用於汽車及機器人應用領域的產品、目標芯片類型、應用場景及主要設計特色：

產品	芯片類型	應用場景	設計特色
FCBGA	ADAS芯片、智能座艙芯片、智能控制芯片	智能輔助駕駛系統、智能座艙、車載影音系統、智能控制單元	- 汽車領域：ADAS芯片負責智能駕駛中的感知與決策，實現多種駕駛輔助功能；智能座艙芯片協調車載影音互動及設備控制，全面提升駕乘舒適性 - 機器人領域：該等芯片作為機器人的決策與執行中樞，以實時算力處理多傳感器信息，確保機器人安全精準完成物理任務 - 層數：6-16層 - 尺寸：23-70毫米 - Cpk>1.67⁽¹⁾

業 務

產品	芯片類型	應用場景	設計特色
FCCSP	智能座艙、 車規級MCU	智能座艙、車載影 音系統、車身控制	● 座艙影音領域：作為車內互動及用戶體驗中心，通過算力及多媒體能力驅動多屏互動及智能服務 ● 車身控制領域：對功能安全及系統穩定性有嚴格要求，確保穩定可靠的行車性能 ● 層數：2-5層 ● ETS線寬／線距精細至7/10μm，開發中產品達6/8μm，mSAP線寬／線距精細至12/16μm ● Cpk>1.67⁽¹⁾
WBCSP及 模組	PMIC、通信芯片、 射頻模組	車載電源管理、車 載網絡	● 負責電源轉換及數據通信，優化成本與功耗 ● 層數：2-9層 ● mSAP線寬／線距精細至25/25μm，蝕刻減成法線寬／線距精細至25/30μm ● Cpk>1.67⁽¹⁾

附註：

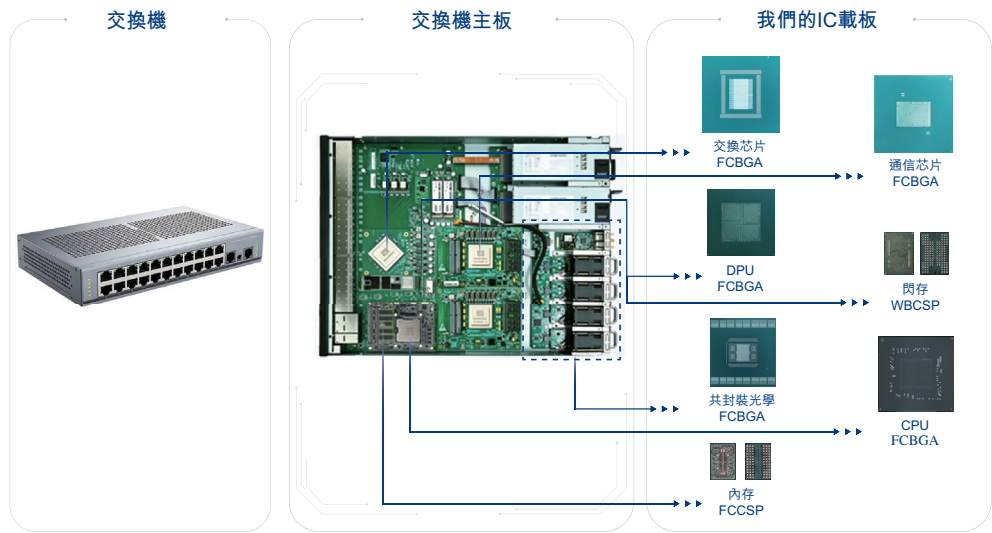
- (1) Cpk指過程能力指數，是一項統計質量管控指標，用以衡量生產製程能否持續生產符合指定公差限值的產品。Cpk>1.67表示生產製程具備充足的製程能力與穩定性，製程變異可有效控制於規格要求範圍內。

網絡通信

網絡通信是IC載板的重要應用領域，受益於5G網絡、高速寬帶、光通信、數據傳輸基礎設施及邊緣計算的持續發展。用於此領域的IC載板通常需要高速信號傳輸、低信號損耗、穩定的電氣性能，其設計通常採用低損耗ABF材料體系與低粗糙度銅面以降低插入損耗與回損。隨著通信網絡持續向更高帶寬、更低延遲及更大數據處理能力演進，對用於網絡處理器、交換機、路由器、基站及相關通信設備的高性能IC載板的需求預期將持續增長。

業 務

下圖為我們的產品集成至交換機的示意圖：



下表載列我們用於網絡通信應用領域的產品、目標芯片類型、應用場景及主要設計特色：

產品	芯片種類	應用場景	設計特色
FCBGA	交換機芯片、通信芯片、DPU	共封裝光學、5G/6G 基站、邊緣路由器	● 支持400G/800G/1.6T及以上高速接口，解決高速信號完整性和高I/O數挑戰 ● 層數：8–20層 ● 尺寸：21–110mm ● 半加成工藝線路低至9/12um，鐳射孔徑低至60um，微錫球數量超30K（開發中產品數量會超過100K）

我們的IC載板

FCBGA載板

FCBGA載板屬於IC載板，其頂面透過倒裝晶片接合承載硅芯片，底面設置焊墊陣列，用以承接BGA焊球，該等焊球為封裝成品的外部端子，供封裝件安裝至印刷電路板。與傳統BGA封裝相比，FCBGA是一種先進的封裝技術。FCBGA封裝通常用於較高的I/O計數，並為最終應用（如AI及HPC）提供改進的電氣和熱性能。該等產品正朝著大尺寸、高層數、低翹曲及高精度方向發展。

我們的FCBGA載板使用味之素增層膜(ABF)材料，旨在支持先進的高性能封裝要求。我們的FCBGA載板主要規格包括：層數4至26層以上，芯板厚度介乎0.15 mm至1.6

業 務

mm，產品尺寸由15 mm×15 mm至120 mm×120 mm，以及線寬／線距為9/12 μ m。我們的技術使我們的產品能夠實現三大主要特點：(1)大尺寸、高層數，(2)低翹曲，及(3)高精度。

- **大尺寸及高層數：**我們開發了專為硅中介層設計的高可靠性載板，解決了垂直互連、熱管理及層間應力平衡等關鍵挑戰。我們的產品展現出國際先進水平的耐熱性及疲勞性能。我們亦在高層數結構設計、高精度層間對位、超低損耗信號傳輸及大尺寸載板翹曲控制等核心技術方面取得突破。該等進步使單芯片尺寸為100 mm×100 mm及24層或以上的先進封裝載板得以量產，以及單芯片尺寸為138 mm×138 mm及28層或以上的先進封裝載板得以研發驗證，滿足了高性能計算應用的嚴格要求。
- **低翹曲：**為解決大型載板在壓合及回流焊等過程中嚴重翹曲的行業普遍挑戰，我們通過低CTE芯材與增層介電材料的匹配設計、高剛性對稱疊構以及精細的熱應力管理流程，結合定制化先進設備，顯著減少了變形、降低了殘餘應力並改善了平坦度。這些技術使我們能夠將最終產品的翹曲度控制在0.1%以內，大幅提高了封裝良率及最終產品的長期可靠性。
- **高精度：**我們的高集成度、高互連密度載板實現了 $\pm 10\mu$ m的層間對位精度，這是指增層中激光鑽孔微孔的精確定位以及防焊開窗與對應焊盤的精確對位，確保了多層電路結構的精確堆疊及互連，並為高頻、高速信號傳輸提供出色的阻抗控制及電氣性能。

FCCSP載板

FCCSP載板採用倒裝芯片互連技術。憑藉其小型化及靈活的結構設計能力，主要用作智能手機及汽車電子的先進細間距封裝載板。

我們的FCCSP載板使用雙馬來酰亞胺三嗪樹脂玻璃纖維覆銅板(BT-CCL)作為基材。其封裝尺寸顯著小於FCBGA載板，使其成為輕量級載體。與WBCSP封裝技術相比，FCCSP旨在提供更高的I/O密度並改善系統性能及穩定性。我們的FCCSP產品採用嵌入式線路設計，線路嵌入於半固化片內以保護精細線路，實現更高密度的互連，主要規格包括：層數2至5層，整體厚度介乎0.08 mm至0.5 mm，產品尺寸由3 mm×3 mm至21 mm×21 mm，以及線寬／線距低至6/8 μ m。我們的技術使我們的產品能夠實現三大主要特點：(1)精細線路，(2)微孔結構，及(3)薄型化設計。

- **精細線路：**我們的嵌入式線路載板(ETS)工藝支持線寬／線距為7/10 μ m的量產，樣品級能力達到6/8 μ m，而我們的mSAP工藝實現線寬／線距為12/16 μ m的量產，樣品級能力達到11/15 μ m。

業 務

- **微孔結構：**我們的微孔加工技術能夠形成直徑低於40 μm 的超細微孔陣列，直徑公差控制在 $\pm 3 \mu\text{m}$ 以內。單個載板可集成數萬至數十萬個微孔。我們的疊孔架構可將存儲芯片帶寬提高20%以上，同時減小封裝尺寸，滿足智能裝置的超薄設計要求。
- **薄型化設計：**我們的設備支持厚度低至40 μm 的IC載板生產，並可針對存儲芯片堆疊應用定制超薄規格，與傳統載板相比厚度減少50%以上。當與無芯載板技術結合時，我們進一步增強了載板的靈活性及空間利用率，兩層產品成品總厚度低至90 μm ，三層無核心產品低至80 μm ，以滿足柔性智能裝置的要求。

WBCSP載板

WBCSP載板是引線鍵合架構的IC載板，也是行業用量最大的基礎型IC載板品類。芯片正裝擺放，通過金線引線鍵合實現芯片與載板電氣互連。這也使WBCSP封裝載板的連接方式更靈活，可支持在一個封裝內堆疊多個芯片。與FCCSP載板相比，WBCSP載板通常涉及較低的技術複雜度及較低的成本，主要用於成熟工藝應用，是對性價比有高要求的芯片封裝的優先選擇，如存儲、智能裝置及汽車。

我們的WBCSP載板主要規格包括：層數2至5層，整體厚度介乎0.12 mm至0.56 mm，產品尺寸由2 mm×2 mm至27 mm×27 mm，以及線寬／線距為12/16 μm 及以上。

模組載板

模組載板主要用於射頻(射頻)系統級封裝載板，將多個異質裸芯片及無源元件封裝在單一封裝內，是射頻模組和天線封裝模組的核心互聯載體。模組載板通常(i)要求高度均勻的線寬及銅厚均勻性，(ii)低介電常數、低介電損耗的高頻材料以確保高頻信號傳輸的完整性，以及(iii)具有高水平的功能集成以實現產品小型化。我們的模組載板主要規格包括：層數2至9層，整體厚度介乎0.13 mm至0.36 mm，產品尺寸由1 mm×1 mm至12 mm×12mm，以及線寬／線距為12/16 μm 。

研發

我們的研發團隊及投資

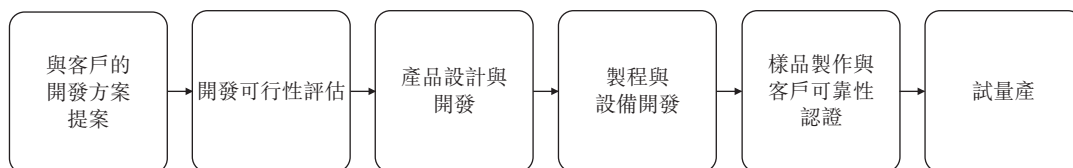
我們對研發的承諾是我們長期增長的關鍵。截至最後實際可行日期，我們的研發團隊由626名員工組成。我們的研發團隊在IC載板技術、產品創新、材料科學及先進製造工藝方面擁有行業經驗。

業 務

於往績記錄期間，我們持續應對根據不斷變化的市場和客戶需求定製及交付IC載板相關的技術和工程挑戰。於2023年、2024年、2025年及截至2025年及2026年3月31日三個月，我們的研發開支分別為人民幣123.4百萬元、人民幣153.8百萬元、人民幣155.8百萬元、人民幣36.8百萬元及人民幣39.2百萬元，分別佔我們總收入的10.4%、7.5%、5.5%、6.8%及4.2%。我們的研發工作已取得多項成果。截至最後實際可行日期，我們擁有236項專利及75項正在申請的專利，涵蓋我們運營的關鍵方面以及其他新興技術領域。有關更多詳情，請參閱「一知識產權」。

我們的研發方針及流程

我們採用結構化、系統化的跨職能研發方法來開發新的IC載板及技術，並持續提升工藝能力。我們基於階段門檻的研發框架，透過整合ProjectLink、OA及SAP系統，實現標準化執行、里程碑控制及跨職能協作，提高了透明度、可追溯性及按時交付能力。下列流程圖載列我們研發流程的主要階段：



- **與客戶的開發方案提案：**我們根據客戶合作機會、客戶的產品路線圖，以及行業技術及市場趨勢，識別及選擇研發項目。這有助於使項目選擇與客戶需求、應用需求、開發目標、預期時間表及預期行業發展保持一致。
- **開發可行性評估：**我們評估技術可行性、市場價值及商業潛力，包括材料可用性、設計複雜性、工藝能力、市場需求、技術生命週期、預期回報及客戶路線圖的一致性。這有助於確保進入正式開發的項目具有清晰的技術路徑及商業合理性。
- **產品設計與開發：**我們完成結構設計，根據客戶需求界定關鍵設計參數及限制，並為後續開發制定初步工藝流程及可製造性設計考量。
- **制程與設備開發：**我們開發及驗證關鍵工藝步驟、工藝窗口及設備／工藝參數，並優化工藝流程以支持可製造性及產品要求，包括大尺寸、高層數、高集成度FCBGA載板及小型化FCCSP、WBCSP及模組載板。
- **樣品製作與客戶可靠性認證：**我們根據批准的設計規則及工藝流程製作工程樣品，將其提供給客戶進行可靠性驗證及性能評估，並在必要時根據測試結果改進產品設計或工藝參數。
- **試量產：**我們進行試產以驗證量產準備情況，包括工藝穩定性及可重複性、瓶頸解決，以及最終確定商業生產的控制計劃及關鍵質量／工藝文件。

業 務

我們的技術

我們的核心技術使我們能夠開發及定制高性能IC載板，以滿足客戶於不同應用場景中不斷演變的需求。我們將持續精進技術能力，旨在提高電路精度、成孔能力、產品穩定性和可靠性，重點關注精細線路形成和孔徑控制。我們在產品設計、材料應用、工藝技術和設備選型方面推進創新，提升產品品質：

- **產品設計。**我們的產品設計能力可滿足AI時代各種前沿場景對IC載板的解決方案。為支持更高算力及更高集成度的先進封裝需求，我們正在開發更高尺寸（> 100 mm）及更高層數（≥30層）的產品。為支持更高密度的互連，我們已開發多種小型化工藝，包括細線路、微孔直徑、精細防焊開窗能力及精細微焊球間距。就精細線路能力而言，我們的半加成工藝可讓樣品級能力達8/8 μ m；我們的改良型半加成工藝可讓樣品級能力達11/15 μ m；我們的嵌入式線路製程可讓樣品級能力達6/8 μ m。我們還開發了微孔能力，可在60 μ m焊盤上生產40 μ m鐳射孔，及微小防焊開口能力，可在60 μ m焊盤上生產40 μ m防焊開口，以及微焊球間距能力低至80 μ m，以適應更高的I/O數量。
- **材料應用。**我們具備多種先進材料的制程能力，構建完整的材料數據體系，能夠在與客戶開發的提案階段完成材料的選型。我們與客戶緊密合作，對使用下一代低熱膨脹系數及低損耗材料（包括CCL、ABF材料、半固化片等）的IC載板進行開發與驗證，可解決高平整性、高頻高速傳輸等難題。我們還開發了銅面微粗化處理工藝，該工藝對線寬／線距要求嚴格的信號層使用低蝕刻量方案，保障精密線路尺寸精度、阻抗穩定性及信號完整性。
- **工藝技術。**我們已開發先進工藝技術以滿足客戶的多樣化要求，包括但不限於：(i)無芯載板技術，旨在消除IC載板傳統上使用的芯層，從而顯著降低封裝的垂直輪廓及整體重量；通過減小介電層厚度，該技術亦可降低信號傳輸延遲、改善信號完整性並支持更高頻率及更高速的數據傳輸；(ii)多芯層技術，涉及用多個薄芯板的堆疊結構替代單個厚芯板，為大封裝尺寸、高功耗及高I/O密度的芯片提供先進解決方案；(iii)嵌入式被動組件技術，旨在將被動組件嵌入載板內部以改善信號完整性、節省空間並增強集成度；及(iv)銅柱技術，用高密度銅柱替代傳統的微焊球，實現更高密度的佈線並增加I/O數量。

業 務

- **設備選型。**我們的智能製造產品配備Stepper曝光機、高精度CO2鐳射機、高精度植球機，關鍵設備能力可覆蓋精細線路、微小孔徑、精細微錫球間距設計。針對其他研發中的技術能力，我們也在積極開發新設備以適應客戶更高階產品的需求，比如多芯層技術的壓合機以及嵌入式被動組件技術的內埋置件機。

知識產權

我們的知識產權對我們的業務運營至關重要。截至最後實際可行日期，我們在全球擁有236項專利(包括188項發明專利)、十一項註冊商標、三項著作權。有關我們重大知識產權組合的更多詳情，請參閱「附錄五—法定及一般資料—B.有關我們業務的進一步資料—2.知識產權」。

我們通過適用的知識產權法律，以及與員工簽署的保密協議來保護我們的知識產權。我們在與員工簽訂的所有僱傭協議中明確了有關知識產權所有權和保護的所有權利和義務。此外，我們要求員工簽署標準協議，規定其在為我們服務期間獲得的任何職務發明、商業秘密及研發成果均應為我們的資產，且該等成果的所有權應轉讓予我們。截至最後實際可行日期，我們的知識產權組合包括若干重大共同擁有專利(定義見下文)。根據我們的中國知識產權法律顧問及美國知識產權法律顧問的意見，(a)本集團有權完整且不受限制地使用該等重大共同擁有專利，並有權獨立使用該等重大共同擁有專利及向第三方授予非獨家許可；(b)本集團有權享有我們從該等重大共同擁有專利獲得的所有收益或收入；及(c)本集團就該等重大共同擁有專利享有的權利不受保留臻鼎集團單方面終止。有關更多詳情，請參閱「與控股股東的關係—不競爭承諾以及—獨立於控股股東—研發」。

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無遇到任何已威脅或待決的知識產權侵權糾紛，而該等糾紛會對我們的業務產生重大不利影響。

生產

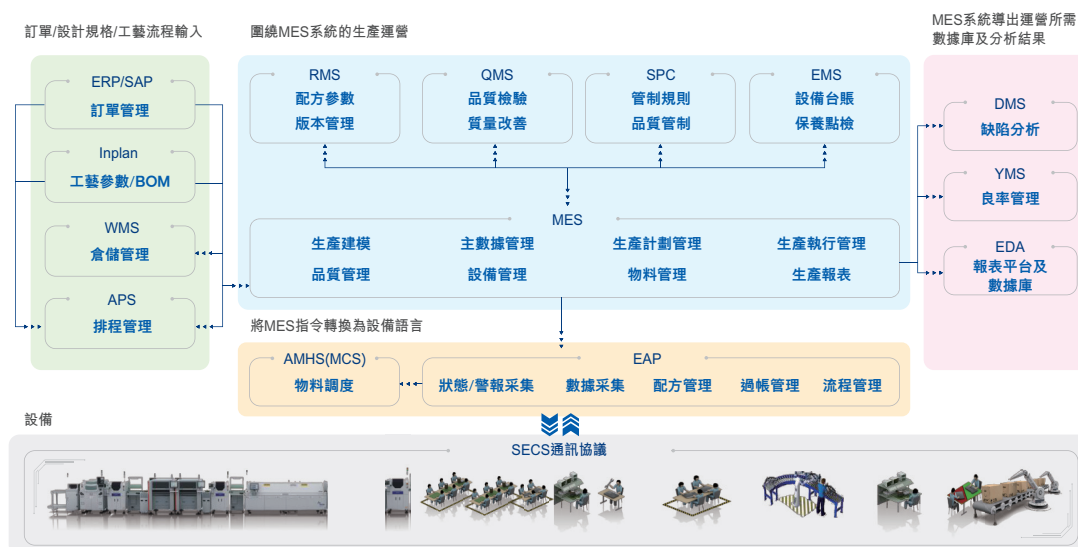
生產流程

智能生產及AI工具應用

根據弗若斯特沙利文的資料，我們是全球首批採用半導體設備通訊標準(SECS)通訊協議的IC載板供應商之一，實現了貫穿產品生命週期的數據驅動控制，確保生產參數穩定且可追溯。我們的製造運營高度自動化及智能化，按照國際標準建立，並得到日本、中國台灣、韓國及德國領先的全球設備供應商的支持。我們利用全流程智能製造，在半導體製造軟件、端到端自動化及支持AI的設計與檢測在統一的數字架構內整合，提高了效率、質量及穩定性。

業 務

我們整合的智能系統連接以製造執行系統(MES)為中心，並整合了訂單、設計、工藝及生產等其他系統。它將不同系統相互連接，形成智能工廠的完整智能系統。此外，在SECS通訊協議的支持下，我們生產設施的數據實時共享並集中管理，實現遠程監控、精準資源調度及知情決策。



- 符合SECS標準的製造設備

我們的生產設備採用半導體行業先進的SECS通訊協議，包括激光直接成像(LDI)、激光鑽孔、高精度AOI、垂直連續電鍍(VCP)及ABF壓合機。有關更多詳情，請參閱「我們的供應鏈—設備」。

- 訂單／設計規格／工藝流程輸入

我們使用SAP系統作為運營中心，整合財務、物料、銷售及製造功能，並將銷售訂單連結到生產。通過Inplan軟件，我們將客戶設計轉換為標準化工單，加快新產品導入。與倉庫管理系統(WMS)及先進計劃系統(APS)整合後，我們實現了生產及物料的實時可見性，提高了供應鏈效率。

- 圍繞MES系統的生產運營

我們以MES為大腦，結合APS(先進排程系統)進行動態排程，最大化產線稼動率以及消除生產瓶頸。結合配方管理系統(RMS)及質量管理系統(QMS)，將傳統「事後抽檢」提升為「全流程實時監控與事前預警」，確保卓越的交付品質。

業 務

- 將MES指令轉換為設備語言

SECS是MES與設備之間建立的嚴格通訊機制，是智能製造的物理基礎。設備自動化程序(EAP)能夠將MES下發的配方(Recipe)和工單指令準確無誤地傳輸給設備；同時，設備的實時運行狀態、溫度、壓力以及警報信息也能通過SECS通道即時回傳至MES和EAP，實現了秒級的數據採集與監控及高度智能化的生產。

- MES系統導出運營所需數據庫及分析結果

系統透過良率管理系統(YMS)及缺陷管理系統(DMS)進行全產線品質回溯。YMS&DMS能夠深度整合MES的生產履歷數據與IC載板的測試數據。結合Fine Business Intelligence及Fine Report Business Intelligence商業智慧平台，對海量生產數據進行深度挖掘與歸因分析，精準鎖定微米級的製程變異原因。並建立數據倉庫對生產數據進行存儲，為了後續系統的搭建和深度挖掘打好基礎。

- AI工具的應用

我們在研發、製造、質量控制及物流領域應用AI，通過系統整合、數據及自動化提高效率，涵蓋智能設計、機器學習與分析、AI輔助生產管理及AI輔助監控。在智能設計方面，我們使用標準化數據庫及AI工具(配合光學字符識別(OCR)及大模型)從圖紙中提取參數並轉換為生產參數。在機器學習與分析方面，我們使用自動化及算法支持數據分析及決策。在AI輔助生產管理方面，我們的高級計劃與排程系統(APS)通過整合多項生產約束(包括設備狀態、在製品水平及處理時間)實現動態調度。在AI輔助監控方面，我們的質量追溯系統，配合檢測、故障檢測與分類(FDC)及預測與健康管理(PHM)系統，實現實時警報及預測性維護。

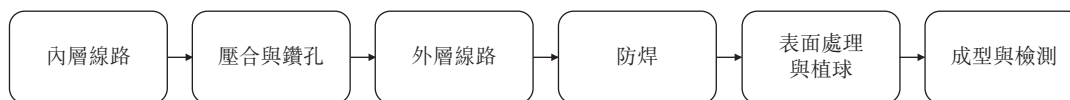
我們的智能生產系統支持持續的質量改進，並使工藝優化能夠標準化並複製到新生產線。這為未來的產能擴張提供了技術支持。此外，我們的財務系統與製造運營整合，生產數據通過SAP處理並轉換為財務信息，提高了財務報告的效率及準確性。

我們的生產流程

生產流程因產品類型和客戶需求而異。下文章節說明了FCBGA、FCCSP(嵌入式及非嵌入式線路類型)、WBCSP及模組載板生產流程中的關鍵步驟。

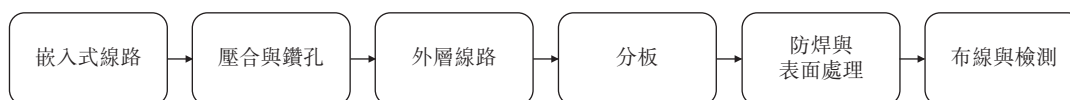
業 務

FCBGA 生產流程



1. **內層線路**：主要包括鑽孔、鍍銅、塞孔及影像轉移，可實現垂直信號互連，並將電路圖案轉移至內層。
2. **壓合與鑽孔**：ABF薄膜在真空環境下熱壓，以提高流動性並形成緻密的絕緣層，隨後通過激光加工及電鍍實現層間導通。
3. **外層線路及ABF增層**：通過影像轉移技術，經除膠渣、化學鍍銅、乾膜壓合、曝光、顯影、電鍍、蝕刻等製程，將設計線路圖案轉移至外層板。
4. **防焊**：防焊涉及施加永久性防焊油墨，以保護非焊接區域，同時暴露焊接區域供後續使用。
5. **表面處理與植球**：表面處理（浸錫／化學鍍鎳化學鍍鈀浸金／OSP）形成氧氣屏障以防止氧化並便於焊接，而微球植球則確保精確的焊球放置及回流焊。
6. **成型與檢測**：產品被切割成出貨單元，並在交付前進行電氣測試及外觀檢查。

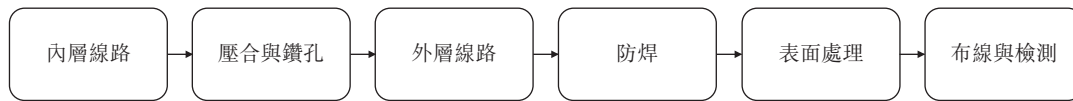
FCCSP (嵌入式) 生產流程



1. **嵌入式線路**：通過電鍍及蝕刻形成電路，將電路嵌入半固化片介電層的樹脂中以提供保護。
2. **壓合與鑽孔**：壓合在高溫高壓下使半固化片軟化，與銅表面結合，而鑽孔及電鍍則實現層間導通。
3. **外層線路**：電路層通過化學鍍銅、乾膜壓合、曝光、顯影、電鍍及蝕刻形成。
4. **分板**：形成嵌入式電路後，可分離式載板被分開並進行加工。
5. **防焊與表面處理**：防焊保護非焊接區域，而表面處理則施加有機保焊膜以防止氧化並便於焊接。
6. **布線與檢測**：產品被切割成所需尺寸，並進行電氣及外觀檢查。

業 務

FCCSP(非嵌入式)、WBCSP及模組生產流程



1. **內層線路**：該製程包括鑽孔、鍍銅及影像轉移，以實現垂直信號傳導並將電路圖案轉移到IC載板上。
2. **壓合與鑽孔**：壓合在高溫高壓下使半固化片軟化，以實現增層及結合，而激光鑽孔及電鍍則實現層間導通。
3. **外層線路**：使用化學鍍銅及影像轉移(蝕刻減成法或mSAP)形成電路層，隨後進行自動光學檢測。
4. **防焊**：防焊涉及施加永久性防焊油墨，以保護非焊接區域，同時暴露焊接區域供後續使用。
5. **表面處理**：表面處理通過軟／硬金電鍍、化學鍍鎳浸金、化學鍍鎳化學鍍鈀浸金及有機保焊膜等製程，在銅導體上形成保護屏障，以防止氧化並確保可焊性。
6. **布線與檢測**：產品被切割成所需尺寸，並進行電氣及外觀檢查。

現有生產設施

我們在快速增長的AI市場中運營，在該市場中，產能往往制約供應鏈中公司的增長潛力。在此背景下，我們策略性地預見了未來的產能需求，並在初始廠房設計中納入大量產能擴充空間，配合分階段的設備安裝方針，以便在實際訂單增長時能夠快速提升產能。有關更多詳情，見「一業務可持續性及盈利能力」。

我們的深圳園區主要專注於FCBGA載板，而我們的秦皇島園區主要專注於FCCSP、WBCSP及模組載板。由於我們的FCBGA與FCCSP、WBCSP及模組載板的技術特性不同，該類產品所使用的原材料、化學品及生產設備大部分有所不同，因此我們在獨立的廠房中生產該等產品。深圳園區現有總建築面積約為213,690.1平方米，而秦皇島園區現有總建築面積為93,499.1平方米。

業 務

下表載列截至最後實際可行日期我們運營中生產設施的若干詳情：

生產設施	地理位置	主要產品	建築面積 (平方米)	大規模 生產年份	擴產至設計 滿負荷產能
深圳一號廠房	中國深圳	FCBGA載板	84,477	2024年	2026年第四季度
秦皇島一號廠房	中國秦皇島	FCCSP、WBCSP、 模組載板	34,131	2013年	2026年第一季度
秦皇島二號廠房	中國秦皇島	高階FCCSP、標準 FCCSP載板	34,580	2022年	2027年第一季度

由於我們在初始工廠設計中已預留大量產能擴充空間，我們的利用率（按滿載設計產能的百分比計量）在開始運營後的頭幾年往往較低。我們分階段在生產設施中安裝設備，並根據客戶的預測需求及預期市場趨勢按月規劃實際生產。我們根據客戶訂單的滾動預測持續監控我們的生產規劃。下表載列我們於所示期間的產能、實際產量及利用率：

	截至12月31日止年度						截至3月31日止三個月	
	2023年		2024年		2025年		2026年	
	件數 ⁽⁴⁾ (千件)	(A)的 百分比	件數 ⁽⁴⁾ (千件)	(A)的 百分比	件數 ⁽⁴⁾ (千件)	(A)的 百分比	件數 ⁽⁴⁾ (千件)	(A)的 百分比
深圳一號廠房								
(A)滿載設計產能 ⁽¹⁾⁽²⁾ . .	3,360	100.0%	3,360	100.0%	3,360	100.0%	840	100.0%
(B)實際裝機產能 ⁽¹⁾⁽³⁾ . .	856	25.5%	1,050	31.3%	1,050	31.3%	302	36.0%
(C)實際產量 ⁽¹⁾	116	3.5%	446	13.3%	727	21.6%	280	33.3%
秦皇島一號廠房								
(A)滿載設計產能 ⁽¹⁾⁽²⁾ . .	1,411	100.0%	1,411	100.0%	1,411	100.0%	353	100.0%
(B)實際裝機產能 ⁽¹⁾⁽³⁾ . .	1,243	88.1%	1,263	89.5%	1,324	93.8%	344	97.5%
(C)實際產量 ⁽¹⁾	927	65.7%	972	68.9%	1,200	85.0%	339	96.0%
秦皇島二號廠房								
(A)滿載設計產能 ⁽¹⁾⁽²⁾ . .	1,008	100.0%	1,008	100.0%	1,008	100.0%	252	100.0%
(B)實際裝機產能 ⁽¹⁾⁽³⁾ . .	425	42.2%	492	48.8%	640	63.5%	180	71.4%
(C)實際產量 ⁽¹⁾	221	21.9%	357	35.4%	526	52.2%	166	65.9%

附註：

- (1) 基於生產流程中的瓶頸階段。對於FCBGA產品，我們將線路增層階段視為瓶頸；對於FCCSP、WBCSP及模組產品，我們將表面處理產量視為瓶頸。

業 務

- (2) 滿載設計產能代表工廠的設計最高產能，根據可置於整體廠房佈局內的設備總量計算。生產時間按期內經例行維護後每月28個滿生產日計算。
- (3) 實際裝機產能代表工廠期內的實際最高產能，根據期內實際安裝於工廠的設備總量計算。生產時間按期內經例行維護後每月28個滿生產日計算，並根據實際運營狀況就年度停工及停產線作出調整。
- (4) 產量以工作件計量，這是生產中使用的標準單位。出貨前，件會被切割成客戶指定的尺寸。

有關我們規劃產能的策略，以及該策略過往及預期如何影響我們的增長及盈利能力的描述，請參閱「一業務可持續性及盈利能力」。

計劃生產設施

我們擬透過擴充現有生產設施及興建新生產設施，逐步進一步提升整體產能，以滿足市場需求。下表概述我們計劃主要生產設施的詳情：

生產設施	地理位置	主要產品	建築面積 (平方米)	預計投產	年度滿載 設計產能 片(千) ⁽¹⁾	於最後實際 可行日期的 狀況
深圳二號廠房	中國深圳	FCBGA	85,278	2027年 第一季度	3,360 ⁽²⁾	設備安裝中

附註：

- (1) 產量以工作件計量，這是生產中使用的標準單位。出貨前，件會被切割成客戶指定的尺寸。
- (2) 基於ABF增層階段計算。指工廠的設計最高產能，根據可置於整體廠房佈局內的設備總量計算。生產時間按期內經例行維護後每月28個滿生產日計算。

質量控制

我們遵守質量控制標準，並已建立全面的質量管理體系，以促進穩定交付合格的IC載板。具體而言，我們遵守國際公認的質量管理體系認證，包括用於整體質量管理一致性的ISO9001；用於IC載板生產過程中有害物質過程管理的IECQ QC080000；用於我們環境管理和可持續發展實踐的ISO14001；以及用於我們職業健康和安全管理管理的ISO45001；用於車載產品質量管理的IATF16949；用於業務連續性管理的ISO22301；用於溫室氣體管理ISO14064；用於產品碳足跡管理的ISO14067；用於能源管理的ISO50001；及用於信息安全管理管理的ISO27001。

我們建立了一支在質量控制方面具有專業知識的專門團隊。我們的質量控制團隊負責我們運營的整體質量管理，並將審查和評估涵蓋整個生產生命週期的各種流程，包括供應商質量評估、進料檢驗、過程質量控制和成品檢驗。

業 務

物流及存貨管理

物流

我們維持高效的物流系統，以提升客戶滿意度及存貨效率。我們按照與客戶協定的條款交付產品。在我們負責交付的情況下，我們委聘合資格的第三方物流供應商，將製成品從我們的生產設施運輸至客戶指定的地點。我們為該等物流供應商制定嚴格的運輸標準，並定期進行合規及績效評估，以確保高效可靠的交付。

存貨管理

我們的存貨主要包括儲存於深圳及秦皇島生產基地的原材料、在製品及製成品。我們指派專人定期向管理層匯報存貨狀況。我們運營SAP系統以管理原材料流入、流出及庫存水平，並利用WMS實現貫穿產品生命週期的數據收集及維持生產參數，同時進行定期盤點以確保準確性。有關更多詳情，請參閱「財務資料—選定資產負債表項目—流動負債淨額—存貨」。

銷售及營銷

我們的銷售網絡

於往績記錄期間，我們主要通過直接銷售方式銷售產品，例如來自OSAT、IC設計及IDM公司的直接訂單。通過直接銷售銷售的大多數產品具有客戶直接要求的定製規格。這種方法使我們能夠提供定製產品並緊密配合客戶需求。

於往績記錄期間，我們並無任何經銷商，惟有一個終端客戶的業務模式涉及貿易夥伴進行集中採購及處理進出口清關則除外。該貿易夥伴作為我們的直接客戶，而透過有關貿易夥伴進行銷售所得收入分別僅佔我們於2023年、2024年、2025年及截至2026年3月31日止三個月總收入的0.2%、0.2%、0.2%、0.2%。我們與該貿易夥伴簽訂了銷售協議，條款與我們其他直接銷售客戶相似。有關更多詳情，請參閱「我們的直接銷售」。我們並無與該貿易夥伴訂立任何經銷協議，亦未授權其獲取終端客戶、代表我們進行談判或為轉售而持有存貨。據我們所知，於往績記錄期間，該貿易夥伴為獨立第三方。於最後實際可行日期，我們並不知悉我們的貿易夥伴有任何可能對我們的聲譽、業務運營或財務狀況造成不利影響的潛在濫用或不當使用我們名稱的行為。

此外，為與韓國及中國台灣客戶建立有效聯繫，我們在韓國及中國台灣聘請了少數代理商。我們通過該等代理商介紹的客戶所產生的收入於2023年、2024年、2025年及截至2026年3月31日止三個月分別佔我們總收入的33.0%、21.5%、1.9%及1.6%。我們於2025年終止了與中國台灣代理商的合作。該等代理商僅提供銷售支持服務，如客戶推薦、業務聯絡和對賬協助，我們直接與客戶處理訂單下達、產品交付和結算付款。

業 務

於往績記錄期間，我們的產品在國內外市場銷售。下表載列往績記錄期間我們按銷售地區劃分的收入：

	截至12月31日止年度						截至3月31日止三個月			
	2023年		2024年		2025年		2025年		2026年	
	人民幣 千元	(%)	人民幣 千元	(%)	人民幣 千元	(%)	人民幣 千元 (未經審計)	(%)	人民幣 千元	(%)
中國內地	429,529	36.3	1,049,891	51.1	1,603,052	56.7	309,324	57.2	526,084	56.9
境外										
中國台灣 . .	714,385	60.4	912,342	44.4	1,079,432	38.2	211,121	39.1	340,200	36.8
其他 ⁽¹⁾	38,948	3.3	93,289	4.5	146,138	5.1	20,081	3.7	57,605	6.3
總計	<u>1,182,862</u>	<u>100.0</u>	<u>2,055,522</u>	<u>100.0</u>	<u>2,828,622</u>	<u>100.0</u>	<u>540,526</u>	<u>100.0</u>	<u>923,889</u>	<u>100.0</u>

附註：

(1) 其他主要包括韓國、新加坡及美國。

我們的直接銷售

我們通過銷售及營銷團隊銷售產品，截至最後實際可行日期，該團隊由74名員工組成。通過直接銷售，我們可以第一手了解客戶的需求和業務發展計劃，並在戰略、技術路線圖和產品開發方面與客戶進行深入合作。與客戶的緊密聯繫使我們能夠有效且高效地銷售產品。我們的客戶通常對IC載板提出定制的產品規格要求，並將對所需產品的關鍵性能進行審查及認證。

於往績記錄期間，我們的客戶主要包括OSAT、IC設計及IDM公司。我們通過Turnkey模式開發及獲取客戶，據此，OSAT公司通常根據其客戶即IC設計公司的要求，主導選擇或推薦載板供應商。在此情況下，與OSAT公司的採購及工程人員保持密切及持續的往來對我們取得商機而言非常重要。我們亦積極開發IC設計及IDM公司作為我們的直接客戶。為識別及開發業務商機，我們通常通過行業排名報告、行業參與者的介紹以及參加展覽會、研討會及其他行業活動來加強我們的市場推廣及客戶拓展。

我們通常與直接銷售客戶訂立框架協議。我們典型直接銷售協議的主要條款如下：

- **期限及終止。**我們通常訂立無固定期限的框架直接銷售協議，該等協議可通過雙方協議終止，或任何一方在協議規定的情況下事先發出書面通知後終止。
- **定價政策。**我們根據採購訂單中雙方商定的價格範圍向直接銷售客戶銷售產品。
- **付款及信貸期。**我們既有預付款客戶，亦有獲授信貸期的客戶。獲授信貸期的客戶於驗收產品後，在約定期限內付款，付款期介乎30至90天。

業 務

- **採購金額。**我們根據框架協議在採購訂單中列明採購金額。
- **產品保證及退貨安排。**除產品缺陷等有限情況外，我們一般不允許直接銷售客戶向我們退貨。
- **交付及物流。**我們負責將產品交付至直接銷售客戶指定的地點。
- **保密性。**該等框架協議通常載有嚴格限制的保密條款，或隨附保密協議附件，限制各方披露機密信息。

定價

我們在定價時考慮多種因素，包括技術競爭力、產品成本和採購量。據弗若斯特沙利文稱，往績記錄期間我們主要產品的定價普遍在行業觀察到的價格範圍內。

營銷

我們通過與廣泛應用領域的領先客戶進行長期、深入的合作，建立了行業認可度。通過採用針對特定終端市場量身定製的差異化營銷和客戶互動策略，我們將資源集中在高增長和戰略重要的應用上，例如AI及HPC、網路通信及車載應用領域。

我們的營銷策略側重於從早期接洽和解決方案設計到量產及交付後支持的整個過程中，與客戶保持密切持續的互動。通過頻繁的技術交流和合作開發計劃，我們能夠深入了解客戶不斷變化的產品需求、技術路線圖和市場趨勢。

這種以客戶為中心的方法使我們能夠有效地定位產品，參與聯合開發項目，及時響應認證和生產過程中的技術挑戰，並提供可靠及時的售後支持。

產品退貨

根據我們的政策及與客戶的協議，售予客戶的產品除因產品設計缺陷及質量問題外，不可退貨。客戶退回產品的價值於2023年佔我們總收入的2.0%，於2024年佔1.3%，於2025年佔0.8%，於截至2026年3月31日止三個月佔0.2%。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無接獲客戶任何重大產品退貨、換貨、投訴或產品責任索償。由於我們並無接獲因對我們業務而言屬重大的產品質量及缺陷而提出的重大客戶投訴或換貨要求，故於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無產生任何重大保修開支或就此等保修開支計提任何撥備。

我們的客戶

於往績記錄期間，我們的客戶主要包括OSAT、IC設計及IDM公司。有關更多詳情，請參閱「我們的直接銷售」。於2023年、2024年、2025年以及截至2026年3月31日止三個月，我們來自前五大客戶產生的收入分別為人民幣962.6百萬元、人民幣1,668.2百

業 務

萬元、人民幣2,165.9百萬元及人民幣628.8百萬元，分別佔我們總收入的81.4%、81.2%、76.6%及68.1%。此外，同期，我們最大客戶產生的收入分別佔我們總收入的37.8%、38.6%、36.4%及29.0%。

除保留臻鼎集團外，我們於往績記錄期間的五大客戶均為獨立第三方。於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，據董事所知，概無董事、其緊密聯繫人或持有本公司已發行股本超過5%的任何股東在保留臻鼎集團以外的任何五大客戶中擁有任何權益。有關與保留臻鼎集團交易的更多詳情，請參閱「關連交易」。據我們所知，截至最後實際可行日期，我們並不知悉任何會導致我們與任何主要客戶關係終止的信息或安排。

下表載列我們於往績記錄期間各期間五大客戶的詳情。

排名	客戶	銷售金額 (人民幣千元)	佔總收入 百分比	所購產品／服務類型	信貸期	建立業務 關係年份 ⁽¹⁾
截至2023年12月31日止年度						
1	客戶A ⁽²⁾ . . .	446,563	37.8	FCBGA、FCCSP、WBCSP	60天	2011年
2	保留臻鼎 集團 ⁽³⁾	279,275	23.6	FCBGA、FCCSP、WBCSP	90天	不適用
3	客戶B ⁽⁴⁾ . . .	131,335	11.1	FCBGA、FCCSP、WBCSP	60天	2018年
4	客戶C ⁽⁵⁾ . . .	62,948	5.3	FCBGA、FCCSP、WBCSP	60–90 天	2015年
5	客戶D ⁽⁶⁾ . . .	42,449	3.6	廢料材料	60天	2019年

附註：

- (1) 指與本集團於2019年後或與保留臻鼎集團於本公司成立前開始業務關係。
- (2) 客戶A為一家於中國台灣註冊成立並在台灣證券交易所上市的OSAT公司。
- (3) 臻鼎為我們的控股股東。除本集團業務外，臻鼎亦於其他業務中擁有權益，該等業務透過不構成本集團一部分的各種直接及間接附屬公司運營。有關更多詳情，請參閱「與控股股東的關係—保留臻鼎集團與本集團之間的業務劃分」。
- (4) 客戶B為一家於中國內地註冊成立並在深圳證券交易所上市的OSAT公司。
- (5) 客戶C為一家於中國台灣註冊成立並在台灣證券交易所上市的OSAT公司。
- (6) 客戶D為在中國內地註冊成立的公司，主要從事工業固體廢物（包括危險工業廢物）的處理和處置，以及提供相關回收和技術服務。

業 務

排名	客戶	銷售金額 (人民幣千元)	佔總收入 百分比	所購產品／服務類型	信貸期	建立業務 關係年份
----	----	-----------------	-------------	-----------	-----	--------------

截至2024年12月31日止年度

1	客戶A	792,408	38.6	FCBGA、FCCSP、WBCSP	60天	2011年
2	客戶B	464,229	22.6	FCBGA、FCCSP、WBCSP	60天	2018年
3	客戶C	216,593	10.5	FCBGA、FCCSP、WBCSP	90天	2015年
4	客戶E ⁽¹⁾	141,910	6.9	FCBGA、FCCSP、WBCSP	60天	2021年
5	客戶F ⁽²⁾	53,050	2.6	FCCSP、WBCSP	60天	2013年

附註：

(1) 客戶E為於中國內地註冊成立的OSAT公司。

(2) 客戶F於中國內地註冊成立並在深圳證券交易所上市的OSAT公司。

排名	客戶	銷售金額 (人民幣千元)	佔總收入 百分比	所購產品／服務類型	信貸期	建立業務 關係年份
----	----	-----------------	-------------	-----------	-----	--------------

截至2025年12月31日止年度

1	客戶A	1,028,694	36.4	FCBGA、FCCSP、WBCSP	60天	2011年
2	客戶B	710,871	25.1	FCBGA、FCCSP、WBCSP	60天	2018年
3	客戶E	183,159	6.5	FCBGA、FCCSP、WBCSP	60天	2021年
4	客戶C	144,630	5.1	FCBGA、FCCSP、WBCSP	90天	2015年
5	客戶G ⁽¹⁾	98,569	3.5	FCCSP、WBCSP	90天	2011年

附註：

(1) 客戶G為於中國台灣註冊成立的OSAT公司，並於台灣證券交易所上市。

業 務

排名	客戶	銷售金額 (人民幣千元)	佔總收入 百分比	所購產品／服務類型	信貸期	業務關係 開始年份
截至2026年3月31日止三個月						
1	客戶A	267,686	29.0	FCBGA、FCCSP、WBCSP	60天	2011年
2	客戶B	206,620	22.4	FCBGA、FCCSP、WBCSP	60天	2018年
3	客戶E	55,001	6.0	FCBGA、FCCSP、WBCSP	60天	2021年
4	客戶C	52,689	5.7	FCBGA、FCCSP、WBCSP	90天	2015年
5	保留臻鼎 集團	46,756	5.1	廢料材料	90天	不適用

客戶集中

於2023年、2024年、2025年及截至2026年3月31日止三個月，我們來自五大客戶的收入分別佔我們收入的81.4%、81.2%、76.6%及68.1%。於同期，我們來自最大客戶的收入分別佔我們收入的37.8%、38.6%、36.4%及29.0%。有關更多詳情，請參閱「風險因素—與我們業務及行業有關的風險—我們的業務、財務狀況及經營業績可能因客戶集中風險而受到不利影響」。根據弗若斯特沙利文，鑑於下游半導體行業對技術要求的嚴謹性及供應鏈穩定性的關鍵需求，IC載板行業的下游客戶群集中於少數領先的OSAT公司。因此，我們對該等市場領先客戶的集中度相對較高。我們擬繼續與該等市場領先客戶保持長期合作及相互技術支持，預期該等客戶將為我們的收入基礎及未來增長作出重大貢獻。由於我們密切監察市場趨勢，我們尋求透過積極與其他市場領導者及新客戶建立關係，進一步擴大我們的客戶基礎，以支持我們業務的可持續增長。

我們的供應鏈

原材料

我們的主要原材料主要包括ABF、CCL(包括BT-CCL)、金鹽及防焊油墨。我們主要從日本及中國內地採購原材料。

我們密切監察市況，並定期與供應商磋商定價及採購條款，以應對原材料價格波動的影響，因為我們IC載板中使用的若干原材料價格會波動。於適當情況下，我們尋求在與客戶協商後，將材料成本變動反映於產品定價。例如，為應對黃金價格波動，我們已與若干客戶磋商價格調整機制。根據該機制，我們的產品售價參考與相關客戶協定的基準金價進行調整。我們亦根據市場趨勢調整採購量及存貨管理策略，旨在根據我們的整體業務運營維持最佳成本效益。就關鍵原材料而言，我們尋求與主要供應商保持密切協調、進行提前採購規劃、監察存貨水平及客戶需求預測，並在商業上可行的情況下，分散供應商基礎。

業 務

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無經歷任何原材料供應嚴重短缺的情況，且我們的供應商提供的原材料亦無任何重大質量問題。

設備

我們的核心生產設備包括激光直接成像(LDI)、激光鑽孔、高精度AOI、垂直連續電鍍(VCP)及ABF壓合設備，主要採購自日本、韓國、中國台灣及中國內地的專業供應商。以下是關鍵高端SECS合格設備的詳情：

- 超精細線路高精度步進式曝光機：此設備用於超精細線路製造中的影像轉移。
- 高精度植球、補球及回流焊一體機：此設備用於先進半導體封裝中的細間距植球。
- 高精度3D微凸塊檢測設備：此設備用於檢測三維微凸塊結構。
- 高均勻性ABF壓合機：此設備用於具有更高均勻性的ABF壓合。
- 高均勻性垂直連續電鍍設備：此設備用於具有更高均勻性的電鍍。
- 全自動彩色AI智能光學檢測設備：此設備用於支持AI的全自動彩色光學檢測。
- 皮秒激光超微孔加工機：此設備用於使用皮秒激光技術鑽削超微孔。

我們通過持續的供應商溝通積極管理採購及維護成本，並使設備規劃與產能擴張保持一致，以提高資產效率。我們與主要供應商保持密切合作，並多元化採購渠道以降低供應風險。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，並無發生重大供應中斷，所有設備均可靠運行，無重大質量或性能問題。

分包商

截至2026年3月31日止三個月，我們向保留臻鼎集團採購若干製成品，總金額為人民幣24,000元。有關更多詳情，請參閱「關連交易—非豁免持續關連交易—6. 框架採購協議」。

此外，於往績記錄期間，我們已將鑽孔及出貨前檢測等技術複雜度較低但設備及人力密集度較高的若干工序外包予專門從事該等工序的獨立第三方承包商。於2023年、2024年、2025年以及截至2025年及2026年3月31日止三個月，我們的外包費交易金額（不包括與保留臻鼎集團的交易金額）分別為人民幣21.4百萬元、人民幣42.5百萬元、人民幣69.5百萬元、人民幣11.3百萬元及人民幣20.5百萬元。

我們與核心獨立分包商保持穩定合作，確保生產計劃、交付要求及質量標準一致，並持續擴大分包商基礎以分散風險。我們的外包商一般須按照我們的規格、圖紙、樣品及技術要求加工產品，妥善管控我們提供的材料及產品，並就因其未能遵守協定標準而產生的

業 務

產品缺陷、返工或損失承擔責任。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們在外包工序中並未遇到任何重大交付延誤、產能短缺或質量問題。

我們的分包協議涵蓋技術規格、定價、檢測責任、採購政策、交付及付款條款，以及保密及ESG義務。分包價格根據工序複雜度及所需加工時間釐定。

我們的供應商

供應商選擇與管理

我們通常聘請信譽良好的供應商以確保產品質量。我們在選擇供應商時會考慮一系列綜合因素，主要包括產品質量、往績記錄和聲譽。此外，我們亦實施措施持續監控最終產品質量。有關更多詳情，請參閱「一質量控制」。

我們通常向主要供應商發出採購訂單，訂明採購的一般條款及條件。下文載列我們採購訂單的主要條款：

- **期限及終止。**倘供應商違約、不履行、不完整履行或交付不合規格產品，我們可全部或部分終止採購訂單，且供應商的保證義務在終止後持續有效。
- **定價及付款。**我們按採購訂單所載價格向供應商購買產品，採購訂單訂明相關產品、貨幣、單價及採購總額。單價通常基於付款前雙方協定的最新價格。付款條款因供應商及採購訂單而異。倘在付款前發現缺陷，我們可暫停付款義務或抵銷應付予供應商的款項。
- **採購數量及預測。**採購數量及交付日期通常於採購訂單中訂明，並可能受我們最新的交付通知或其他交付要求所規限。我們發出的任何預測僅供規劃用途，不構成我們的採購義務。
- **交付。**供應商須根據採購訂單及我們最新的交付通知或要求中的交付條款、交付日期及其他要求，將產品交付至我們指定的地點。供應商可能須就延遲交付承擔延遲罰款及相關損失。
- **產品保修及退貨安排。**除非另有規定或適用更長期間，否則供應商一般保證在五年保修期內，產品符合我們的規格及要求，且無缺陷、留置權及第三方知識產權侵權索償。對於不合規格產品，我們可退貨、拒收、要求維修或更換、扣除付款、以供應商費用採購替代產品、終止採購訂單並索償相關損失。

業 務

我們的主要供應商

於往績記錄期間，於2023年、2024年、2025年及截至2026年3月31日止三個月，向五大供應商的採購額分別為人民幣299.1百萬元、人民幣408.2百萬元、人民幣712.0百萬元及人民幣275.3百萬元，分別佔我們總採購額的35.0%、34.9%、41.7%及46.6%。此外，同期，向最大供應商的採購額分別佔我們總採購額的11.5%、10.4%、16.6%及20.6%。所有五大供應商於往績記錄期間均為獨立第三方。於往績記錄期間，我們的董事及彼等各自的聯繫人或持有我們已發行股份總數5%以上的股東，概無於我們五大供應商中擁有任何權益。此外，於往績記錄期間，我們與供應商並無發生任何重大糾紛。

下表載列往績記錄期間各期間我們五大供應商的詳情：

排名	供應商	採購金額 (人民幣千元)	佔採購總額 百分比	產品／服務類型	信貸期	業務關係 開始年份 ⁽⁶⁾
----	-----	-----------------	--------------	---------	-----	-----------------------------

截至2023年12月31日止年度

1	供應商A ⁽¹⁾ . . .	98,021	11.5	金鹽	按發票付款	2016年
2	供應商B ⁽²⁾ . . .	61,598	7.2	油墨	90日	2018年
3	供應商C ⁽³⁾ . . .	56,855	6.7	CCL、半固化片	45日	2019年
4	供應商D ⁽⁴⁾ . . .	42,930	5.0	CCL、半固化片	60日	2019年
5	供應商E ⁽⁵⁾ . . .	39,713	4.6	化學藥水	90日	2018年

附註：

- (1) 供應商A為於中國內地註冊成立的私營公司，主要從事貴金屬化工材料及相關電子材料的開發、生產及銷售。
- (2) 供應商B於日本註冊成立，並在東京證券交易所上市。其主要通過子公司開展業務，從事電子行業用化學產品（包括防焊油墨及相關材料）的製造及銷售。
- (3) 供應商C為於日本註冊成立的私營公司，主要從事塑料材料及相關產品的國內及國際貿易、銷售、進出口及物流服務。
- (4) 供應商D為在韓國註冊成立的公司，並在韓國交易所上市，主要從事電子材料（包括用於電子應用的CCL及其他材料）的製造和銷售。
- (5) 供應商E為一家納斯達克上市公司，主要為電鍍、印刷電路板製造及表面處理應用提供特種化學品、設備、軟件和服務。
- (6) 指與本集團的業務關係於2019年後開始，或與保留臻鼎集團的業務關係於本公司成立前開始。

業 務

排名	供應商	採購金額 (人民幣千元)	佔採購總額 百分比	所提供產品／服務類型	信貸期	業務關係 開始年份
----	-----	-----------------	--------------	------------	-----	--------------

截至2024年12月31日止年度

1	供應商A	121,625	10.4	金鹽	按發票付款	2016年
2	供應商F ⁽¹⁾ . . .	83,064	7.1	ABF	30日	2022年
3	供應商B	79,743	6.8	油墨	90日	2018年
4	供應商C	74,019	6.3	CCL、半固化片	45日	2019年
5	供應商E	49,766	4.2	化學藥水	90日	2018年

附註：

- (1) 供應商F為於日本註冊成立的私營公司，主要從事電子材料、功能性化學品及活性炭產品的製造及銷售。

排名	供應商	採購金額 (人民幣千元)	佔採購總額 百分比	所提供產品／服務類型	信貸期	建立業務 關係年份
----	-----	-----------------	--------------	------------	-----	--------------

截至2025年12月31日止年度

1	供應商A	282,878	16.6	金鹽	按發票付款	2016年
2	供應商C	124,578	7.3	CCL、半固化片	45日	2019年
3	供應商F	108,664	6.4	ABF	30日	2022年
4	供應商G ⁽¹⁾ . . .	102,784	6.0	CCL、半固化片	60日	2022年
5	供應商B	93,101	5.4	油墨	90日	2018年

附註：

- (1) 供應商G為於日本註冊成立的公司，並於東京證券交易所上市。其主要透過子公司營運，從事化工業務，包括半導體及電子材料。

業 務

排名	供應商	採購金額 (人民幣千元)	佔總採購 百分比	所提供產品／服務類型	信貸期	業務關係 開始年份
----	-----	-----------------	-------------	------------	-----	--------------

截至2026年3月31日止三個月

1	供應商A	121,414	20.6	金鹽	按發票付款	2016年
2	供應商G	54,306	9.2	CCL、半固化片	60日	2022年
3	供應商C	43,559	7.4	CCL、半固化片	45日	2019年
4	供應商F	33,933	5.7	ABF	30日	2022年
5	供應商B	22,082	3.7	油墨	90日	2018年

客戶與供應商重疊

保留臻鼎集團是我們的客戶，亦是我們的供應商。特別是，於2023年及2026年第一季度，保留臻鼎集團是我們的前五大客戶之一。然而，與保留臻鼎集團的銷售及採購性質不同。於2023年，我們向保留臻鼎集團出售若干產品以供其轉售予我們的終端客戶，這純粹是因為我們作為臻鼎集團當時的業務單位，尚未完成相關的客戶驗證流程。該安排於2023年稍後在我們完成該客戶驗證後終止。此外，臻鼎集團若干成員公司擁有相關許可證及必要的廢物處理專業知識，我們向該等實體出售廢料。有關該交易的詳細原因，請參閱「關連交易—非豁免持續關連交易—7.廢料及廢棄材料銷售框架協議」。另一方面，我們向保留臻鼎集團中擁有相關許可證並在我們深圳及秦皇島生產設施內或附近運營的若干成員公司採購廢物處理及污水處理服務。有關該等交易的詳細原因，請參閱「關連交易—完全豁免持續關連交易—2.廢物處理服務框架協議」及「關連交易—部分豁免持續關連交易—污水處理服務框架協議」。此類集團內安排於企業集團內一家子公司向同一集團內另一家子公司提供商品或服務的情況並不少見。除保留臻鼎集團外，我們與若干第三方廢物處理公司亦維持類似安排，該等公司與我們存在重疊的客戶及供應商關係，據此，我們向其銷售廢料，產生收入，並向其支付廢物處理服務費。

我們的董事確認，我們與重疊客戶及供應商進行的所有銷售及採購均按正常商業條款在日常業務過程中進行，且屬公平交易。於2023年、2024年、2025年以及截至2025年及2026年3月31日止三個月，來自保留臻鼎集團的收入分別為人民幣279.3百萬元、人民幣1.5百萬元、人民幣69.0百萬元、人民幣0.3百萬元及人民幣46.8百萬元，分別約佔我們同期總收入的23.6%、0.1%、2.4%、0.1%及5.1%。於2023年、2024年、2025年以及截至2025年及2026年3月31日止三個月，保留臻鼎集團的採購額分別為人民幣96.8百萬元、人民幣94.6百萬元、人民幣97.4百萬元、人民幣23.3百萬元及人民幣25.6百萬元，分別佔我們同期總採購額的3.4%、5.0%、4.1%、5.4%及3.3%。

業 務

有關關稅的最新法規

於2025年4月，美國宣佈對來自所有國家的進口商品徵收大範圍關稅，包括對所有國家徵收10%的所謂「基準」關稅、對若干貿易夥伴徵收不同水平的所謂「對等」關稅，以及對來自中國內地、中國香港、中國澳門的貨物徵收20%的所謂「芬太尼相關」關稅。截至2025年4月初，美國已對大部分來自中國內地、中國香港、中國澳門的進口商品徵收145%的關稅，中國政府則對大部分來自美國的商品徵收125%的關稅作為回應。於2025年5月12日，經雙邊談判後，中國及美國宣佈對彼此大部分商品徵收的該等較高關稅暫停90天，期間美國將繼續對中國進口商品徵收30%關稅，而中國將對美國商品維持10%關稅。兩國其後將該暫停措施進一步延長90天至2025年11月10日。於2025年10月30日兩國貿易談判後，美國同意暫停對中國產品徵收24%的對等關稅一年，並將對中國產品的芬太尼相關關稅降低10%。此外，中國同意調整其就上述美國關稅的相應反制措施，而兩國同意繼續延長若干關稅豁免。於2026年2月20日，美國最高法院裁定，《國際緊急經濟權力法》並無授權總統徵收關稅，包括對等關稅及芬太尼相關關稅。自2026年2月24日起，美國海關當局停止徵收該等關稅。與此同時，特朗普總統發佈公告，自2026年2月24日起對所有進口至美國的商品徵收10%的臨時進口附加費，為期150天。

於往績記錄期間，出口至美國的收入佔我們總收入不足1%。因此，美國關稅制度的變動並未對我們的業務運營、財務狀況或經營業績造成任何直接重大不利影響。然而，概不保證我們的業務不會受到美國關稅政策未來變動或其他地緣政治發展（包括對我們供應鏈、客戶或更廣泛市場狀況的潛在間接影響）的不利影響。

與受國際制裁國家／地區有關的業務活動

與受美國出口管制採購項目有關的採購活動

於往績記錄期間，我們採購了受EAR規管並歸類為出口管制分類編號(ECCN) 3A999.F、4A994.L、5D992.C、6A003及EAR99的項目（採購組件）。向受制裁實體（特別是外國資產控制辦公室指定的特別指定國民（「SDN」）或工業與安全局列入實體清單的實體）提供受EAR管制的項目乃被禁止。

歸類為3A999.F的採購組件因反恐原因及地區穩定原因而受管制，倘該等項目出口、再出口或轉讓（在國內）至伊拉克及巴基斯坦（我們並非位於該等國家），則會觸發許可證要求。歸類為4A994.L及5D992.C的採購組件僅因反恐原因而受管制。因反恐原因而受管制的項目，其出口、再出口或轉讓（在國內）涉及(i)實體清單、被拒絕人員名單或未經驗證清單所列實體；及／或(ii)總部位於、通常居住於任何受全面貿易禁運國家／地區以及俄羅斯及白俄羅斯（統稱「反恐制裁國家」），或由其政府擁有或控制的實體時，須取得許可證(i)及(ii)項下的該等實體統稱為「反恐限制制裁目標」。歸類為6A003

業 務

的採購組件須取得出口許可證規定，而我們的供應商已就向我們銷售取得所需許可證。歸類為EAR99的採購組件一般為低技術消費品，在大多數情況下（包括我們的採購）無需許可證。

據我們的國際制裁法律顧問告知，我們於往績記錄期間對該等採購項目的採購並不構成違反適用的美國出口管制，原因為(i)我們並非反恐限制制裁目標，我們採購該等受反恐限制管制的採購項目無需許可證；(ii)該等採購項目概無供應予任何反恐制裁國家、反恐限制制裁目標、伊拉克及巴基斯坦；及(iii)歸類為6A003的採購項目僅限於我們現有設施內部使用，並未出口、再出口或轉讓（在國內）予任何第三方，而我們的供應商已就向我們銷售取得所需許可證。

與受國際制裁實體有關的銷售活動

於往績記錄期間，我們並無與位於全面受制裁國家的任何交易對手進行交易。我們曾與工業與安全局維護的實體清單所列的若干客戶（實體清單客戶）進行交易。向實體清單所列實體提供受EAR管制的項目乃被禁止。據我們的國際制裁法律顧問告知，由於我們與實體清單客戶的交易並不涉及轉讓任何受EAR管制的項目、技術或材料，我們的交易並不構成違反制裁法規。

信息安全及資料隱私

我們認識到，數據的機密性、完整性和可用性對我們的運營至關重要。我們嚴格遵守不斷發展的數據安全和隱私法律法規，確保我們的業務和交易數據按照最高標準進行管理，包括《中華人民共和國網絡安全法》、《中華人民共和國個人信息保護法》及《中華人民共和國數據安全法》。

數據收集。我們主要在正常業務運營過程中收集、處理和存儲與生產、製造和庫存管理相關的數據。

數據傳輸。我們不進行用戶數據的跨境傳輸。來自我們中國內地生產基地的所有數據均存儲在中國內地境內。未經事先明確同意，我們不會將收集到的數據共享或轉移給任何第三方。除非根據法院或行政命令要求，我們禁止向任何第三方披露收集到的數據。

數據保護

為確保數據保護並維護敏感信息的機密性，我們實施了安全措施，旨在防止未經授權的訪問並減輕潛在風險：(i)數據加密。我們採用先進的加密技術保護靜態和傳輸中的敏感業務數據，防止未經授權的訪問，降低數據洩露風險；(ii)訪問控制。對我們數據的訪問受到嚴格監管，僅根據角色和職責授予授權員工權限。敏感信息僅限具有適當權限的人員訪問，確保數據安全處理；(iii)物理訪問控制。對我們設施和網絡的進入僅限

業 務

於授權人員。訪客必須在抵達時登記，對安全區域的訪問受到嚴格控制，需要事先批准；及(iv)員工培訓。我們為所有員工提供持續的數據隱私和安全培訓，確保遵守數據保護政策，並提高對如何安全處理敏感信息的認識。

信息安全框架

我們制定了內部政策和一系列程序，以進行有效的信息和網絡安全管理。這些內部政策和程序的關鍵包括(i)網絡安全，我們採用防火牆、防病毒軟件和入侵檢測系統來保護我們的網絡基礎設施免受外部威脅，(ii)數據保護及隱私，我們維護一套數據處理和存儲協議，包括加密、訪問控制和定期數據備份，(iii)安全審計和測試，我們定期進行漏洞評估，以評估我們系統的穩健性，(iv)員工培訓，我們提供定期培訓計劃以提高整體安全意識，及(v)災難恢復計劃，我們制定災難計劃以確保關鍵IT系統和數據的恢復。於往績記錄期間，我們沒有經歷任何客戶機密信息洩露或任何其他可能對我們的業務、財務狀況或經營業績造成重大不利影響的客戶信息相關事件。據我們的中國法律顧問告知，於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，我們已遵守中國有關數據隱私、網絡安全及個人資料保護的適用法律法規。

競爭

我們在競爭激烈且技術密集的行業中運營，客戶要求更先進、更高可靠性的IC載板。根據弗若斯特沙利文的資料，中國內地IC載板市場相對集中且競爭激烈，2025年前三大製造商佔市場份額的37.9%。FCBGA載板的行業集中度較高，中國內地前三大的FCBGA載板製造商合計佔據58.7%的市場份額。全球IC載板市場亦相對集中且競爭激烈，2025年前三大製造商佔市場份額的37.4%。

我們主要在技術及工藝要求以及技術經驗方面與其他中國內地IC載板製造商競爭。我們主要在國際市場基於我們的規模擴張能力、技術及工藝要求、客戶認證及關係、供應鏈管理、經驗豐富的技術及管理團隊以及智能製造能力進行競爭。有關更多詳情，請參閱「行業概覽」。

業務可持續性及盈利能力

我們在快速增長的AI市場中運營，在該市場中，產能往往制約供應鏈中公司的增長潛力。在此背景下，我們策略性地預見了未來的產能需求，並在初始廠房設計中納入大量產能擴充空間，配合分階段的設備安裝方針，以便在實際訂單增長時能夠快速提升產能。由於此項策略，我們產生了大量前期資本開支，因而產生折舊開支，而當時我們的收入仍然相對較小。這導致2023年及2024年錄得毛損人民幣504.5百萬元及人民幣105.5百萬元，以及2023年、2024年及2025年分別錄得虧損淨額人民幣753.1百萬元、人民幣405.1百萬元及人民幣328.7百萬元。

此項策略有助我們於往績記錄期間成功把握AI市場增長的機遇。我們的總收入由2023年的人民幣1,182.9百萬元快速增長至2024年的人民幣2,055.5百萬元及2025年的人民幣2,828.6百萬元，複合年增長率為54.6%。我們的收入增加至截至2026年3月31日止三個

業 務

月的人民幣923.9百萬元，較2025年同期增長70.9%。來自AI及HPC應用產品的收入由2023年的人民幣26.9百萬元激增至2025年的人民幣716.2百萬元，複合年增長率為416.1%。鑑於新建生產廠房的準備時間較長，這種前期投資策略賦予我們相對於主要競爭對手的顯著競爭優勢。根據弗若斯特沙利文的資料，按2025年收入計，我們在位於中國內地的IC載板製造商中排名第三，較2023年的第六名上升。按IC載板收入計，於2025年全球前20大IC載板供應商中，我們在2023年至2025年的收入複合年增長率排名第一。

隨著我們的產能利用率隨著時間推移而提高，我們達到了明顯的轉折點，於2025年轉為毛利人民幣100.1百萬元，且我們於截至2026年3月31日止三個月錄得淨利潤人民幣50.1百萬元。我們預期將繼續受惠於我們的大量前期資本開支，以實現可持續增長及具正毛利的盈利能力。

為AI機遇投資

為實施我們的擴張策略，我們進行了大量前期投資及持續投資於生產廠房建設、生產設備以及智能製造系統，為改善產品質量奠定了堅實基礎，並使我們能夠累積豐富的產能擴充經驗。因此，我們在往績記錄期間前已產生大量資本開支，從而在往績記錄期間前已產生折舊。於2023年1月1日，我們的物業、廠房及設備、使用權資產及無形資產成本為人民幣5,466.1百萬元。於2023年、2024年、2025年12月31日及2026年3月31日，該等數字進一步增加至分別為人民幣7,463.3百萬元、人民幣8,421.5百萬元、人民幣8,696.2百萬元及人民幣8,775.1百萬元。計入銷售成本的折舊及攤銷於2023年、2024年、2025年以及截至2025年及2026年3月31日止三個月分別為人民幣422.5百萬元、人民幣591.4百萬元、人民幣651.3百萬元、人民幣155.5百萬元及人民幣183.5百萬元。我們預期將繼續進行大量資本開支投資，以把握AI市場的未來增長。

推動收入增長及錄得正毛利率

我們的收入由2023年的人民幣1,182.9百萬元快速增長至2024年的人民幣2,055.5百萬元及2025年的人民幣2,828.6百萬元。我們的收入亦增加至截至2026年3月31日止三個月的人民幣923.9百萬元，較2025年同期增長70.9%。伴隨這一增長，由於我們的收入由2023年至2025年快速增長，我們實現了規模經濟效益。我們的銷售成本佔收入的百分比由2023年的142.7%顯著下降至2024年的105.1%，並進一步下降至2025年的96.5%。尤其是，銷售成本項下的折舊及攤銷佔收入的百分比由2023年的35.7%顯著下降至2024年的28.8%，並進一步下降至2025年的23.0%。該等變化推動我們的毛利率由2023年的-42.7%改善至2024年的-5.1%，並於2025年轉為正數3.5%。此改善在2026年進一步加速，截至2026年3月31日止三個月毛利達至人民幣146.6百萬元，毛利率改善至15.9%。

提升運營效率及發揮規模經濟效益

我們的收入增長亦提升了我們的運營效率。佔收入的百分比方面，我們的銷售及營銷開支由2023年的1.8%下降至2024年的1.5%、2025年的1.0%及截至2026年3月31日止三個月的0.7%；我們的一般及行政開支由2023年的8.0%下降至2024年的4.8%、2025年的3.7%及進一步下降至截至2026年3月31日止三個月的2.6%；而我們的研發開支由2023年的10.4%下降至2024年的7.5%、2025年的5.5%及截至2026年3月31日止三個月的4.2%。該等變化連同毛利率的改善，推動虧損淨額率由2023年的63.7%大幅收窄至2025年的11.6%。此改善趨勢最終在截至2026年3月31日止三個月轉為純利，標誌著我們通往盈利之路的重要轉折點。

業 務

基於上述情況，我們的董事認為，儘管我們於往績記錄期間錄得過往虧損，但本集團擁有可持續的業務增長，且我們能夠實現盈利運營。上述前瞻性陳述乃基於對我們目前及未來的業務策略以及我們所處市場環境的假設。該等前瞻性陳述涉及風險、不確定性及其他因素，其中部分因素超出我們的控制範圍，可能導致實際業績、表現或成就或行業業績與前瞻性陳述明示或暗示的任何未來業績、表現或成就存在重大差異。相關風險的更多詳情，請參閱「前瞻性陳述」。

環境、社會及管治

我們相信，環境、社會及管治(ESG)考量對我們的長期可持續發展至關重要。我們致力於促進可持續實踐、推動社會責任並維持良好的管治標準。我們持續努力加強我們的ESG管治框架，提升我們的ESG實踐及表現，並通過各項ESG舉措為社區及社會福祉作出積極貢獻。

為配合2050年實現碳中和的目標及全球對綠色、低碳及可持續發展的重視保持一致，我們旨在將綠色製造原則貫穿於我們運營的全生命週期，從研發、生產製造到日常管理。秉承「以科技造福人類；以環保守護綠色地球」的企業使命，我們擬持續投資於環境管理、能源及低碳管理，以及節能減碳舉措。

ESG管治架構

我們已將ESG考量整合到我們的整體戰略、長期規劃、關鍵決策過程及日常運營中。我們的ESG管治框架由董事會、審計委員會以及可持續發展工作小組組成。董事會承擔最終責任，監督框架，審閱可持續發展報告，並制定、批准及審閱我們的ESG願景、政策及目標。

在確定關鍵ESG事宜時，我們的董事會考慮適用的法律、法規及國際認可標準，包括上市規則下的ESG報告守則、聯合國可持續發展目標、全球報告倡議組織的指引以及可持續發展會計準則委員會制定的標準。董事會監督重大議題，包括資源使用、污染控制和供應鏈盡職審查，並將該等議題納入我們的策略及運營管理。在董事會的監督下，可持續發展工作小組制定並推廣可持續發展政策，監察ESG表現，監督ESG披露，並促進遵守最佳實踐。

ESG風險管理

我們意識到ESG事宜對我們的業務戰略、財務表現及運營的重要性。我們已建立ESG風險管理框架，以系統性地識別、評估及緩解因不斷變化的社會趨勢、監管變化及市場動態而產生的ESG相關風險及機遇。主要的ESG相關風險包括日益嚴格的環境及有害物質法規，如RoHS 2.0、REACH及加州65號提案，這可能增加合規成本並推動創新。

業 務

為減輕這些風險，我們系統地監察相關的國際和地方法規以及客戶的環保要求，並將其納入我們的外部文件管理系統進行全面評估和整合。這有助於迅速響應、加強合規並降低不合規風險。

我們已建立清晰有效的溝通渠道，通過數字化和傳統方式與利益相關者（包括員工、客戶、供應商、監管機構及社會）進行互動。基於我們的業務背景和利益相關者的關注，我們已識別並處理重大ESG議題，包括氣候變化緩解、節水、減廢、員工福祉、供應鏈可持續性及社區參與。於往績記錄期間，我們並不知悉任何重大的ESG相關不合規事件。

氣候相關風險及轉型計劃管理

我們已識別並評估可能影響我們業務運營的一系列氣候相關風險，包括極端高溫、乾旱、強降雨和洪水。我們積極監察氣象預警，並根據預警級別實施有針對性的應急行動，以保障人員安全及維持業務連續性。在評估氣候相關風險時，我們考慮現有及新興的法規、技術發展、市場狀況、合規要求、聲譽事宜以及當前和長期的實體風險。

極端高溫和乾旱可能增加運營成本，並可能導致運營中斷。收到天氣預警後，我們會立即通知相關部門，為可能發生的高溫相關緊急情況做好準備，增加設備檢查以確保安全運行。

關於氣候相關轉型風險，我們對碳定價的財務影響進行了有針對性的情景分析。這項評估對於將氣候考量納入我們的長期戰略決策至關重要。利用央行與監管機構綠色金融網絡的情景（特別是「國家自主貢獻」和「淨零排放2050」路徑），我們模擬了對我們運營的潛在財務影響。

我們的氣候轉型計劃旨在實現運營脫碳、增強氣候適應能力並推動長期可持續增長。我們已實施內部碳定價機制，作為我們投資評估流程的一部分。我們的主要轉型舉措包括推廣節能技術、擴大可再生能源組合、開發先進的減廢技術以實現有價值金屬100%回收的目標，且我們已於2025年實現超過50%的廢水回收率、加強氣候適應措施以及與供應商在環保項目上合作。

環境指標及管理

我們將環境管理融入我們的企業戰略、運營及管治。於往績記錄期間，我們並未因環境違規而受到任何重大處罰。

業 務

排放物

我們通過投資於污染預防並聚焦源頭控制，有效管理廢氣、廢水及固體廢物。在空氣質量方面，我們使用非耗臭氧層製冷劑。我們通過多級沖洗減少廢水，並在排放前進行現場預處理。所有固體廢物均經過仔細分類，並儲存在安全、合規的設施中以防止污染，確保安全的處理。下表載列我們於往績記錄期間的廢氣排放明細¹：

	截至12月31日止年度			截至3月31日 止三個月
	2023年	2024年	2025年	2026年
氮氧化物(NO _x)排放量(公斤)	1.53	1.15	1.05	0.32
硫氧化物(SO _x)排放量(公斤)	0.14	0.20	0.17	0.04
顆粒物 ⁽¹⁾ 排放量(公斤)	0.13	0.09	0.08	0.03

附註：

(1) PM指顆粒物，即懸浮於空氣中的微小固體或液體顆粒。

作為我們減少環境影響承諾的一部分，我們的溫室氣體(GHG)管理政策與我們的業務運營以及所有相關法律法規保持一致。下表載列我們於往績記錄期間的範圍1及範圍2排放明細：

	截至12月31日止年度			截至3月31日 止三個月
	2023年	2024年	2025年	2026年
範圍1溫室氣體排放量 (噸二氧化碳當量) ⁽¹⁾	10,521.99	12,160.95	13,360.90	5,095.51
範圍2溫室氣體排放量 (噸二氧化碳當量) ⁽²⁾	123,510.38	107,961.27	117,200.69	32,151.53
範圍1+2溫室氣體排放總量 (噸二氧化碳當量)	134,032.37	120,122.21	130,561.59	37,247.03
範圍1+2溫室氣體排放總量密度 (噸二氧化碳當量／ 人民幣百萬元收入)	113.31	58.44	46.15	40.40

附註：

(1) 二氧化碳當量噸指二氧化碳當量噸，是衡量碳足跡的標準單位。

(2) 範圍1溫室氣體排放量根據香港聯交所發佈的「附錄二：環境關鍵績效指標匯報指引」及英國環境、食品及鄉村事務部發佈的「環境報告指引：包括強制性溫室氣體排放報告指引」中的排放因子計算。全球升溫潛能值參考政府間氣候變化專門委員會第六次評估報告。

(3) 範圍2溫室氣體排放量為本公司消耗外購電力所產生的間接溫室氣體排放。中國內地運營的排放因子參考中華人民共和國生態環境部及國際能源署(香港及中國境外地點適用)。

¹ 空氣排放來自液化石油氣及柴油燃料的消耗。所採用的排放因子乃基於香港聯交所頒佈的「附錄二：環境關鍵績效指標匯報指引」。

業 務

根據我們對自身發展階段及周邊環境狀況的評估，我們已採用溫室氣體減排策略，重點關注減少溫室氣體排放及降低能源使用量，目標於2050年前達成。我們的策略包括實施全熱回收冷水機組、磁懸浮冰機、永磁電機、壓縮空氣熱回收、高效線切割機、化學品再利用及諧波電機測試等技術。

就範圍3排放而言，我們正在進行進一步研究及執行全面計算，以於未來提供更準確及有意義的數據。

資源消耗

我們的主要運營資源包括能源、水及包裝材料。我們積極致力於節約能源及減少資源消耗。下表載列我們於往績記錄期間的能源消耗明細：

	截至12月31日止年度			截至3月31日 止三個月
	2023年	2024年	2025年	2026年
電力消耗(吉焦)	576,010.66	662,798.47	752,909.01	194,673.07
熱力消耗(吉焦)	42,290.11	48,051.86	49,096.51	32,023.57
汽油消耗(吉焦)	256.82	410.17	345.63	80.75
柴油消耗(吉焦)	37.23	35.87	6.95	3.98
天然氣消耗(吉焦)	172,144.33	177,400.88	199,190.05	55,987.21
能源消耗總量 ⁽¹⁾	790,739.16	888,697.25	1,001,548.15	282,768.57
(吉焦／百萬人民幣收入) . . .				
能源消耗強度	668.50	432.35	345.63	306.70

附註：

- (1) 固定燃燒源及車輛中化石燃料的能源消耗參考香港聯交所發佈的「附錄C2：環境、社會及管治報告守則」計算。

我們的深圳及秦皇島生產基地已實施並獲得ISO 14001環境管理體系認證。我們已安裝磁懸浮冰水機組及風扇過濾單元回風系統，並捕獲和再利用工業空壓機和鍋爐廢氣的熱量。我們還實施了用於動態能耗數據收集和實時監控的智能技術系統，該系統與我們的能源管理平台集成，以持續跟蹤高耗能設備的用電情況。

水資源管理

我們在日常運營中優先考慮實用的水資源管理。我們專注於通過有針對性地改進生產流程來減少用水量，包括優化設備、改進清潔程序和收集雨水以最大限度地減少用水量。我們深圳生產廠房的廢水處理系統已獲提升，目標達致50%的廢水回用率。

業 務

為了監測廢水，我們採用在線監測系統，並將實時數據上傳到國家排放平台，以實現可追溯性。我們也會每週進行分析以識別異常情況並監控趨勢波動。我們已部署六套污水處理單元，使污染物濃度水平達標率達100%。下表載列我們於往績記錄期間的水資源使用表現：

	截至12月31日止年度			截至3月31日 止三個月
	2023年	2024年	2025年	2026年
耗水量(立方米)	1,782,248.39	2,297,207.83	2,568,071.53	664,958.94
耗水強度(立方米／ 百萬人民幣收入)	1,506.73	1,117.58	907.84	721.24

廢物管理

我們優先考慮廢物最小化、資源回收和安全處置，將可持續發展原則融入設計、採購和生產實踐中，以減少原材料使用並防止廢物產生。我們的固體廢物系統管理可回收和不可回收的工業廢物、危險廢物和生活垃圾。

我們制定了針對異常情況的政策，並在處理危險化學廢棄物洩漏等緊急情況時參照「糾正及預防措施管理程序」及相關規定。我們的分級回收方法強調現場物料再利用、內部回收以及與供應商及合作夥伴的合作，以最大程度地提高回收率。不可回收的廢棄物由合資格供應商處理以進行安全處置，包括在適當時進行能源回收。年度培訓、實時追蹤及定期審核確保有效的廢棄物管理監督。

下表載列我們於往績記錄期間的廢物管理表現：

	截至12月31日止年度			截至3月31日 止三個月
	2023年	2024年	2025年	2026年
危險廢物(噸)	22,401.23	48,215.84	55,454.10	17,318.09
危險廢物強度 (噸／百萬人民幣收入)	18.94	23.46	19.60	18.78
非危險廢物(噸)	782.44	1,054.44	1,366.88	464.66
非危險廢物強度 (噸／百萬人民幣收入)	0.66	0.51	0.48	0.50
包裝材料(噸)	206.13	383.97	469.55	192.51

社會責任

僱傭、培訓及員工福利

我們遵守我們運營所在司法管轄區適用的僱傭法律法規，包括中華人民共和國勞動法、中華人民共和國勞動合同法、中華人民共和國社會保險法及禁止使用童工規定。我們已建立內部管理制度以保護員工的合法權利，並在我們的運營中對童工、歧視、騷擾及強制勞動實行零容忍政策。

業 務

我們實施基於績效和包容性的招聘流程，以確保平等的就業機會，並支持員工追求適合其技能和抱負的職業。於往績記錄期間，我們並不知悉任何與童工或強制勞動相關的法律法規的重大不合規事件。

下表載列我們於往績記錄期間的選定員工數據：

	截至12月31日止年度			截至3月31日 止三個月
	2023年	2024年	2025年	2026年
按性別劃分：				
男性	2,244	2,452	2,585	2,892
女性	1,125	1,209	1,356	1,429
按地區劃分：				
中國內地	3,315	3,610	3,891	4,270
境外	54	51	50	51

我們致力於員工的專業發展，並為他們提供履行職責和適應不斷變化的技術環境所需的技能和知識。於往績記錄期間，我們與內部專家及外部專家合作，提供了專業發展課程，主題包括行業分析、人權保護、中高層管理人員領導力計劃、人工智能課程系列、數字化轉型高階規劃及績效管理。我們亦提供了面對面培訓課程及在線課程，鼓勵員工進行自願性的自主學習。

我們相信，具有支持性和包容性的工作環境有助於提高生產力及促進員工發展。我們通過設立員工食堂、康樂設施等，與員工互動，促進其權益並確保公平待遇。我們亦設有由員工服務郵箱、意見箱及權益保護熱線組成的多方位溝通平台，讓員工可以自由表達他們的需求及疑慮，從而使我們能夠更好地解決該等問題。

職業健康與安全

我們致力於為員工和承包商維持安全健康的工作環境，遵守相關法律法規，包括中華人民共和國職業病防治法、工作場所職業衛生管理規定及其他相關工作場所健康與安全要求。我們已在園區實施ISO 45001:2018職業健康與安全管理體系，該體系為持續改善安全績效和法規合規性提供了框架。

為降低運營中的職業健康與安全風險，我們通過機器人及自動化升級工廠，例如在高風險工序中使用自動導引車及機械臂，並在各製造廠區設立由管理人員監督的專門安全團隊。於往績記錄期間，我們並不知悉任何與我們運營相關的重大事故。

業 務

供應鏈管理

我們的供應鏈對於確保高效運營及符合我們標準的產品質量至關重要。我們已建立一個全面的供應鏈管理系統，由董事會監督下的一個專門供應商管理部門負責管理。我們通過實施陽光政策及其他內部框架（包括《供應商社會責任管理規定》及《供應商衝突礦產管理規定》），監控供應商的誠信、質量、交付、技術支持及定價。供應商亦須遵守國際標準，如《經合組織跨國企業準則》、《聯合國全球契約》及《世界人權宣言》。

反賄賂及反腐敗

我們對一切形式的腐敗行為保持零容忍態度，並嚴格遵守適用的反腐 法律法規。所有員工在加入本集團時均需確認並承諾遵守誠信廉潔條款，任何違反行為將根據適用法律法規處理。我們還制定了針對員工和商業合作夥伴的行為準則和反腐敗政策，嚴格禁止為獲得不當商業優勢而作出或提供賄賂、回扣、過度饋贈或款待以及其他不當付款。

我們提供入職及持續的反腐敗培訓以提高員工的法律意識和道德標準。2025年，所有員工均接受了反腐敗培訓，累計培訓時間達1,561小時。我們還執行內部控制以確保誠信和透明度，包括由人力資源部管理的利益衝突申報、採購部進行的供應商審查，以及由經濟管理單位對報告案例和物料申領的核實。我們要求準確的賬簿和記錄，並嚴禁虛假發票、異常或解釋不充分的付款，以及誤導性、不完整或虛假的記錄。

我們已建立用於舉報腐敗相關事件的保密舉報制度。員工可通過專用熱線或董事長信箱提交報告。審計部負責報告的初步評估，如需進行正式調查，將由來自法律、人力資源、審計及其他相關部門的成員組成的多部門調查小組進行調查並決定必要的行動。

員工

截至最後實際可行日期，我們共有4,568名全職員工。於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，我們大部分員工位於中國內地。下表載列截至最後實際可行日期按職能劃分的員工人數明細。

職能	人數	佔總人數百分比
研發	626	13.7 %
銷售及營銷	74	1.6 %
生產	3,664	80.2 %
行政	204	4.5 %
總計	4,568	100.0 %

業 務

我們與員工簽訂標準僱傭協議，涵蓋有關保密、知識產權、僱傭、商業道德及不競爭的事宜，特別是在其受僱於我們期間及之後生效的不競爭條款。

我們高度重視員工的潛能，並投入大量精力和資源招聘和培訓員工。除了通過專業招聘公司及其他第三方進行的常規招聘計劃外，我們還實施了內部推薦政策，以吸引潛在人才加入我們。鑑於人才培養的長期效益，我們定期為員工提供內部培訓計劃，以提高他們的技術知識，鞏固他們的行業知識和專業技能。

於往績記錄期間，我們聘用若干派遣員工擔任臨時、輔助或替代職位。截至最後實際可行日期，我們聘用16名派遣合約員工。根據《勞動合同法》及其修訂案，派遣員工僅可擔任臨時、輔助或替代職位。於2014年3月1日生效的《勞務派遣暫行規定》進一步規定，用人單位使用的派遣員工數量不得超過其勞動力總數的10%。於往績記錄期間，我們聘用的派遣員工人數不超過我們勞動力總數的10%。

根據中國法律法規的要求，我們參加多項政府法定員工福利計劃，包括社會保險計劃，即養老、醫療、失業、工傷及生育保險計劃，以及住房公積金。截至最後實際可行日期，我們並未按照相關中國法律法規的要求為若干員工足額繳納社會保險及住房公積金。社會保險供款的短缺金額於2023年、2024年、2025年及截至2026年3月31日止三個月分別為人民幣7.3百萬元、人民幣8.9百萬元、人民幣10.5百萬元及人民幣1.9百萬元。住房公積金供款的短缺金額於2023年、2024年、2025年及截至2026年3月31日止三個月分別為人民幣0.6百萬元、人民幣0.4百萬元、人民幣0.2百萬元及人民幣0.05百萬元。截至最後實際可行日期，我們未曾被政府主管機關責令改正，亦未曾因未能為員工足額繳納社會保險費及住房公積金供款而受到任何行政處罰，且我們與員工之間並無有關社會保險及住房公積金的重大爭議。此外，我們已糾正員工社會保險費的少繳問題，並將根據適用的合規要求，於適當時候糾正員工住房公積金及住房公積金供款的少繳問題。因此，據我們的中國法律顧問告知，我們因未能提供足額社會保險供款而遭受重大行政處罰的可能性較低。有關更多詳情，請參閱「風險因素—與我們業務及行業有關的風險—未能遵守中國社會保險法及住房公積金管理條例或其他中國勞動相關法規，可能使我們遭受罰款及其他法律或行政制裁」。

我們相信，我們與員工保持良好的工作關係，且於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，我們未曾經歷任何重大勞資糾紛、罷工、抗議或招聘員工方面的任何困難。

保險

我們為日常運營維持保險保障。我們的保單主要包括信貸保險、員工相關保險、財產一切險、產品責任保險、產品安全責任保險及運輸保險。我們及時審查我們的保單，

業 務

以確保其符合中國法定法律法規。我們相信，我們現有的保險保障足以應付我們的業務運營，且符合我們運營所在國家的行業標準。

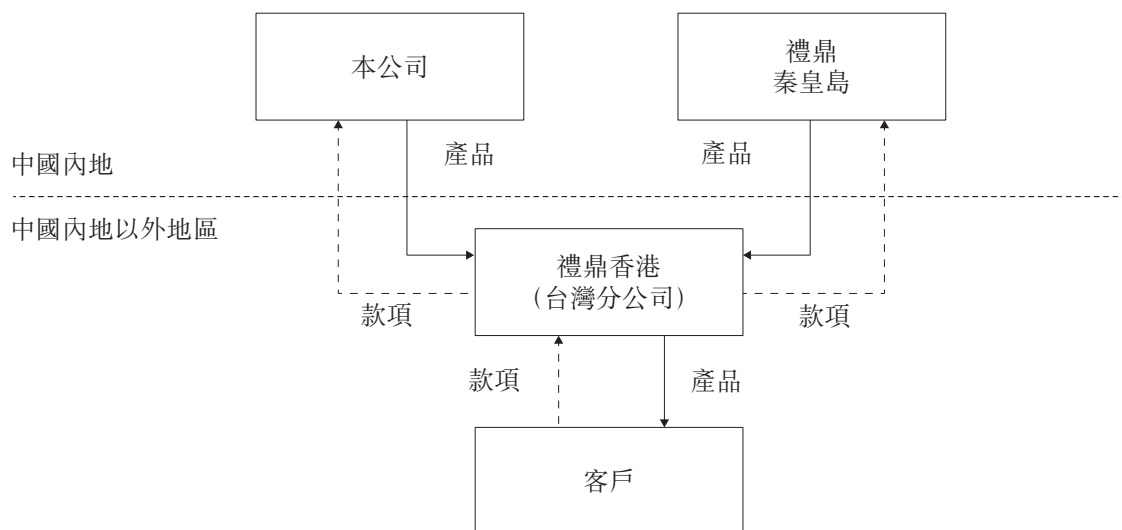
於往績記錄期間，我們並無涉及任何重大保險索償。儘管如此，我們可能面臨超出我們保險保障範圍的索償和責任。

集團間交易

概述

於往績記錄期間，在一般業務過程中，我們在中國內地及中國台灣的實體之間進行了若干集團間交易。於2023年、2024年、2025年及截至2026年3月31日止三個月，集團間交易金額分別為人民幣634.3百萬元、人民幣1,317.6百萬元、人民幣1,450.3百萬元及人民幣472.1百萬元。該等交易涉及IC載板的集團間銷售，由我們在中國內地的製造實體銷售予禮鼎台灣，再由禮鼎台灣將該等產品轉售予第三方客戶，並保留合理的毛利率以支付其運營及銷售開支。

中國內地實體的所得稅稅率為25%。本公司符合高新技術企業資格適用的優惠稅務政策，於截至2025年12月31日止年度及截至2026年3月31日止三個月有權享有15%的所得稅稅率。禮鼎秦皇島符合高新技術企業資格適用的優惠稅務政策，於截至2024年及2025年12月31日止年度以及截至2026年3月31日止三個月有權享有15%的所得稅稅率。禮鼎台灣的所得稅稅率為20%。本公司及禮鼎秦皇島為中國內地的製造實體，而禮鼎台灣則承擔分銷職能。下圖說明我們的跨境集團內交易。



轉讓定價評估

我們已委聘轉讓定價顧問對我們於往績記錄期間的集團間交易進行審閱，該等交易包括(i)本公司及禮鼎秦皇島向禮鼎台灣跨境集團間銷售IC載板，由禮鼎台灣其後將該等

業 務

產品轉售予第三方客戶，並保留合理毛利率以支付其營運及銷售開支，定價方式旨在讓禮鼎台灣得以保留該等利潤；(ii)我們在中國內地的製造實體之間銷售IC載板，因客戶指定等原因而不保留任何利潤；(iii)固定資產轉讓，一般參考相關固定資產的賬面淨值；及(iv)公司間融資，利率一般參考同期類似融資安排的適用利率釐定。

轉讓定價顧問遵循經濟合作與發展組織(經合組織)轉讓定價指南(轉讓定價指南)所載的指引，該等指引與我們集團間交易涉及的司法管轄區的稅法大體一致。根據經合組織轉讓定價指南，集團間交易應按公平基準進行，以避免在不同司法管轄區出現扭曲的應納稅所得額。

轉讓定價顧問審閱了往績記錄期間我們中國內地生產實體向禮鼎台灣進行的跨境集團間IC載板銷售，並進行了功能及風險分析、基準分析及特殊因素分析。

轉讓定價顧問認為，上述關聯方交易整體上符合中國內地及中國台灣的公平原則及適用的轉讓定價法規，且於往績記錄期間應無重大轉讓定價調整。

物業

自有物業

土地

於最後實際可行日期，我們在中國內地深圳及秦皇島擁有並佔用三塊土地的土地使用權，園區總佔地面積為122,970.5平方米，主要用於工業設施及倉庫。於最後實際可行日期，我們已取得我們擁有及佔用的所有地塊的所有土地使用權證。

建築物或單位

截至最後實際可行日期，我們在中國內地深圳及秦皇島擁有八棟建築物或單位，總建築面積約259,875.9平方米，主要用作工業設施、倉庫及辦公室。截至最後實際可行日期，我們已就我們擁有的所有建築物取得全部建築物所有權證書。

租賃物業

截至最後實際可行日期，我們在中國內地的深圳及秦皇島租賃了九處物業，總租賃面積約為約48,748.2平方米，主要用作我們的生產設施、員工宿舍及辦公室。我們員工宿舍的租賃面積按月根據實際佔用房間數目釐定，因此並無計入上述總面積。截至最後實際可行日期，我們亦在中國台灣租賃了一處物業，總租賃面積約為611.6平方米，用作我們的辦公室。

業 務

缺少出租人的有效產權證書

截至最後實際可行日期，我們尚未從出租人處收到我們在中國內地租賃的九處物業中三處的相關不動產權證書或授權文件，該等物業根據與出租人訂立的租賃協議用於員工宿舍。因此，我們無法保證該等出租人有權將該等物業出租予我們。根據我們的中國法律顧問的告知，上述租賃物業僅用作員工宿舍，而不用於任何生產或研發活動。因此，該等物業相對易於替代。此外，截至最後實際可行日期，我們並無收到任何要求我們停止使用該等租賃物業的通知。我們的中國法律顧問認為，出租人未能提供所有權證書不會對我們的運營造成重大不利影響。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們在與出租人磋商續租時並無遇到重大困難。我們相信，在中國內地及我們經營所在的其他司法管轄區，用作員工宿舍的物業供應充足。

租賃協議未辦理登記

根據適用的中國法律法規，物業租賃協議應向中國住房和城鄉建設部相關地方分支機構辦理登記。截至最後實際可行日期，我們尚未就中國內地九處租賃物業中的七處（用於員工宿舍及辦公室）完成租賃登記。根據我們的中國法律顧問的告知，未辦理登記不會影響租賃協議的效力，不會影響我們根據其相關條文對該等租賃物業的合法及有效使用，亦不會對我們的運營造成重大不利影響。

有關出租方未能提供有效權屬證文件且租賃協議未辦理備案登記的詳情，請參閱「風險因素—與我們業務及行業有關的風險—若未能就我們若干物業及租賃物業重續租約或遵守中國物業相關法律及法規，可能會對我們的業務、財務狀況及經營業績造成不利影響」。

物業估值

除戴德梁行所編製估值報告中描述的物業權益外，本集團並無擁有構成非物業活動一部分且根據上市規則第5.01B(2)(b)條其賬面值佔總資產15%或以上的其他單一自有物業權益。有關物業估值報告的更多詳情，請參閱「附錄三一物業估值報告」。

業 務

牌照、批准及許可證

截至最後實際可行日期，我們已從相關政府當局獲得對我們在中國內地、中國香港及中國台灣的業務運營屬重大的所有必要牌照、批准及許可證。我們需要不時續新該等證書、許可證及牌照，我們持續監督相關法律法規的遵守情況。於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，我們在續新牌照、批准及許可證方面並未遇到任何重大困難，目前我們預計此類續新亦不會有任何重大困難。

下表載列若干重大牌照、批准及許可證：

編號	證書持有人	證書／ 許可證名稱	簽發日期	有效期	簽發機構
1	發行人	AEO高級認證 企業證書	2024年 1月31日	長期	中華人民共和國深圳海關
2	發行人	輻射安全許可證	2026年 6月11日	2027年 8月11日	深圳市生態環境局
3	發行人	高新技術企業證書	2025年 12月25日	2028年 12月25日	深圳市工業和信息化局、深圳市 財政局及國家稅務總局深圳市 稅務局
4	發行人	污染物排放許可證	2025年 7月10日	2030年 7月9日	深圳市生態環境局寶安管理局
5	發行人	排水許可證	2022年 10月21日	2027年 10月20日	深圳市寶安區水務局
6	秦皇島 子公司	AEO高級認證企業 證書	2023年 9月8日	長期	中華人民共和國石家莊海關
7	秦皇島 子公司	輻射安全許可證	2023年 10月18日	2028年 10月17日	秦皇島市生態環境局
8	秦皇島 子公司	高新技術企業證書	2024年 11月11日	2027年 11月11日	河北省科學技術廳、河北省財 政廳及國家稅務總局河北省稅 務局
9	秦皇島 子公司	污染物排放許可證	2023年 12月14日	2028年 12月13日	秦皇島市行政審批局

業 務

獎項及表彰

下表載列截至最後實際可行日期，我們獲得的重要獎項及表彰。

重要獎項／表彰	獲獎年份	頒獎機構／主管部門
高新技術企業	2025年	深圳市工業和信息化局、深圳市財政局、國家稅務總局
2025年獨角獸企業	2025年	北京市長城企業戰略研究所
深圳行業領袖企業百強— 第28位	2025年	深圳市工商業聯合會、深圳報業集團
深圳市綠色工廠	2025年	深圳市工業和信息化局
河北省先進級智慧工廠	2025年	河北省工業和信息化廳
專精特新中小企業	2024年	深圳市中小企業服務局
2024年度高新技術企業	2024年	河北省科學技術廳、河北省財政廳、河北省國稅稅務局、河北省地方稅務局
河北省單項冠軍產品—IC載板	2021年	河北省工業和信息化廳

法律程序及合規

於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，我們並無涉及任何我們認為會對我們的業務、經營業績、財務狀況或聲譽及合規產生重大不利影響的實際或待決法律、仲裁或行政程序（包括任何破產或接管程序）。

於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，我們並無涉及任何已導致罰款、執法行動或其他處罰的重大不合規事件，而該等事件單獨或總體而言可能對我們的業務、經營業績及財務狀況產生重大不利影響。

據我們的中國法律顧問告知，於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，我們從事的業務運營在所有重大方面均按照適用的中國法律法規進行。

業 務

內部監控及風險管理

我們設有健全的風險管理及內部監控體系。我們採納並持續改進我們的內部監控機制，包括為我們的業務運營量身定制的政策及程序，以時刻保障我們的業務運營及資產。我們的董事會共同負責建立和實施此類風險管理機制，並監督我們的整體風險管理。

財務報告風險管理

為有效管理財務報告風險，我們已採納全面的會計政策，涵蓋財務管理、預算管理及財務報表編製。這些政策得到既定程序的支持，我們的財務部門根據這些程序定期審查管理賬目。我們已成立審計委員會，以審查和監督我們的財務報告流程和內部監控體系。

合規風險管理

我們已建立完善的合規風險管理程序，以有效識別和管理合規風險，並確保我們的運營符合適用法律法規。根據該等程序，我們的法律團隊仔細審查我們與客戶、供應商及業務合作夥伴訂立的合同。我們的法律團隊亦負責獲取任何必要的政府許可、批准或同意。此外，我們持續監控相關法律法規以及監管環境的變化，以確保我們業務運營的合規性。

知識產權風險管理

我們深明保護知識產權對維持競爭優勢及降低潛在風險的重要性。為確保穩健保護，我們已實施全面的知識產權管理系統，並輔以明確的政策及主動措施，包括制定管理目標、界定各部門職責、規劃及監察知識產權相關目標，以及實施合規管理及績效評估機制。

人力資源風險管理

我們已為人力資源建立全面的內部監控和風險管理政策，涵蓋招聘、培訓、職業道德和法律合規。我們的招聘流程有助於確保新員工的素質。我們還為不同部門的員工提供定期和專門的培訓。這些培訓有助於確保員工的技能組合保持最新，並使他們能夠發現和滿足客戶需求。我們定期進行績效考核，並將薪酬與績效結果掛鉤。此外，我們密切監控內部風險管理政策的執行情況，旨在及時發現和處理任何可能違反我們的行為守則、道德標準或內部政策的行為。

反貪污風險管理

我們通過全面的政策維護商業道德和誠信，包括反賄賂行為守則。我們維持舉報人機制以進行匿名舉報，並由內部審計部門監督。所有舉報將根據批准的計劃進行調查，調查結果將記錄在案並提交給相關管理層。內部審計部門確保為舉報人嚴格保密。此外，我們要求業務合作夥伴在入職過程中簽署業務合作夥伴商業行為守則或其他誠信協議。

截至最後實際可行日期，我們未曾涉及與貪污、賄賂或欺詐相關的法律訴訟。